

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年5月2日(02.05.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/090448 A1

(51) 国際特許分類:

B22F 1/00 (2022.01) B22F 10/34 (2021.01)
B22D 11/00 (2006.01) B22F 10/38 (2021.01)
B22F 1/052 (2022.01) B22F 10/64 (2021.01)
B22F 1/16 (2022.01) B33Y 10/00 (2015.01)
B22F 3/24 (2006.01) B33Y 70/00 (2020.01)
B22F 9/08 (2006.01) C22C 9/00 (2006.01)
B22F 10/00 (2021.01) C22C 9/06 (2006.01)
B22F 10/28 (2021.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/038395

(22) 国際出願日: 2023年10月24日(24.10.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-169924 2022年10月24日(24.10.2022) JP

(71) 出願人: 三菱マテリアル株式会社 (MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 平野 晋吾 (HIRANO Shingo); 〒1008117 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 三菱マテリアル株式会社内 Tokyo (JP). 大久保 清之 (OKUBO Kiyoyuki); 〒1008117 東京都千代田区

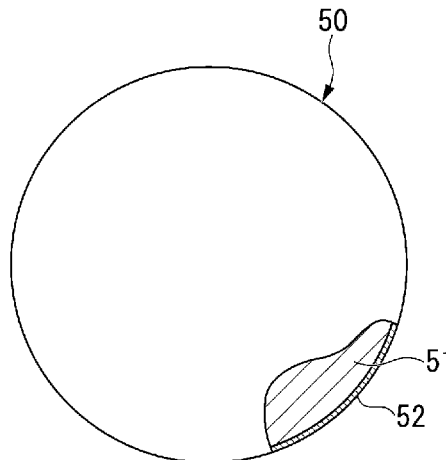
丸の内三丁目2番3号 三菱マテリアル株式会社内 Tokyo (JP). 熊谷 訓 (KUMAGAI Satoshi); 〒5900906 大阪府堺市堺区三宝町8丁374番地 三菱マテリアル株式会社 三宝製作所内 Osaka (JP). 加藤 純 (KATO Jun); 〒3308508 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目600番地 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター内 Saitama (JP). 池田 裕明 (IKEDA Hiroaki); 〒3308508 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目600番地 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター内 Saitama (JP). 峰 和久 (MINE Kazuhisa); 〒3110102 茨城県那珂市向山1002番地14 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター内 Ibaraki (JP). 二田 伸康 (NITA Nobuyasu); 〒3110102 茨城県那珂市向山1002番地14 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター内 Ibaraki (JP). 今直誓 (KON Naochika); 〒3110102 茨城県那珂市向山1002番地14 三菱マテリアル株式会社 イノベーションセンター内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 松沼 泰史, 外 (MATSUNUMA Yasushi et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

(54) Title: COPPER ALLOY POWDER FOR METAL ADDITIVE MANUFACTURING (AM) AND METHOD FOR PRODUCING LAMINATE MOLDED ARTICLE

(54) 発明の名称: 金属AM用銅合金粉末および積層造形物の製造方法



(57) Abstract: This copper alloy powder for metal AM is composed of a copper alloy containing Cr, and a Cr compound layer having a Cr-containing compound is formed on the surface of the copper alloy particles constituting the copper alloy powder.

(57) 要約: この金属AM用銅合金粉末は、Crを含有する銅合金からなり、銅合金粉末を構成する銅合金粒子の表面にCr含有化合物を有するCr化合物層が形成されている。



WO 2024/090448 A1

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

明 細 書

発明の名称：金属AM用銅合金粉末および積層造形物の製造方法
技術分野

[0001] 本発明は、金属アディティブ・マニュファクチャリング（金属AM）技術に最適な金属AM用銅合金粉末、および、積層造形物の製造方法に関する。

本願は、2022年10月24日に、日本に出願された特願2022-169924号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

[0002] 近年、様々な立体形状を有する金属部品を製造する手法として、主に原料として粉を用いて金属3Dプリンターで製品を造形する金属AM技術が実用化されている。金属粉末を用いた主な金属AM技術としては、電子ビームやレーザー光を用いた粉末床熔融法（パウダー・ベッド・フュージョン：PBF）、バインダジェット法等が挙げられる。

ここで、銅合金は、導電性、熱伝導性、機械的特性、耐摩耗性、耐熱性など工業的な応用に適した多数の基本的性質を有しており、各種部材の素材として利用されている。そこで、近年、宇宙、電気部品応用など様々な分野において、銅合金粉末を用いた金属AMにより、様々な形状の部材を形成することが試行され、金属AMで製造された銅及び銅合金の部品のニーズが高まっている。

[0003] 例えば、特許文献1には、CrとSiのいずれかを有する銅合金粉末を用いて、金属AMによる積層造形物を作成する技術が提案されている。

また、特許文献2においては、CrとZrを有する銅合金粉末を用いて、金属AMによる積層造形物を作成する技術が提案されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2016-211062号公報

特許文献2：特開2019-070169号公報

非特許文献

- [0005] 非特許文献1: Y. M. Arisoy et. al., "Influence of scan strategy and process parameters on microstructure and its optimization in additively manufactured nickel alloy 625 via laser powder bed fusion", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 90, p. p. 1393–1417 (2017).

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0006] 金属AMにより造形される金属構造体は、様々な用途に応じて何らかの構造部材として用いられることになるため、積層造形体の中にボイドが存在する場合や金属材料としての微細構造が不均一である場合には、熱機械的また電気的な信頼性の点で問題となる。

現在、金属AMで最も多く使用されている造形方式はレーザーPBFであり、銅及び銅合金においても、レーザーPBFによる造形が試みられてきている。

ところで、レーザー光や電子線を照射する方法で積層造形する際には、まず薄い粉末の層を形成し（粉末床）、続いてこの粉末床にレーザーや電子線を局所的に照射して材料を溶融凝固させる。しかし、銅及び銅合金においては、鉄、チタン、ニッケル系などの他の金属材料と比較して、銅そのものが可視、赤外域の光に対する反射率が高いことなどが原因となり、レーザーPBFの過程で銅合金粉末の溶融挙動が不安定となり、作製された積層造形物の内部にボイドが発生しやすく、レーザーPBFで製造した造形体の品質が安定しない、生産性が悪いなどの課題が山積しており、レーザーPBFにより製造された銅及び銅合金の生産性及び品質の改善が求められてきている。

- [0007] 現在、最も広く使用されている金属AM用原料の形態は粉末である。例えば、レーザーPBFを用いた金属AMにおいては、原料粉末を構成する粒子の表面層の電磁波とのカップリング・相互作用による粒子の電磁波の吸収特性が、原料粉末の溶融挙動に影響を及ぼし、部品の生産性や部品の欠陥密度

を含む品質に大きく影響する。例えば、粉末床を用いる金属AMプロセスにおいては、一回の積層過程で形成される粉末床の厚みは例えば数10 μ m程度であり（非特許文献1）、収束した電磁波をこのような比較的薄い粉末床に照射することにより原料粉末を溶融させ、更に数多くの積層と溶融凝固を繰り返すことにより所望の造形構造を実現する。粉末床を用いるこのような積層造形の素過程に大きな影響を及ぼすのが固体の電磁波の吸収特性であり、例えば、固体の電磁波の吸収特性は材料組成により影響されるため、粉末の材料組成や微細構造の均一性を高めることは、積層造形物全体において安定した品質を実現することや高い生産性の実現において極めて重要となる。

[0008] ここで、銅及び銅合金における電磁波の吸収特性は、例えば、単純に銅以外の成分として、目的のレーザー波長の吸収率が高い物質を添加することで改善可能である。しかしながら、過去の多くの冶金研究が示すように、銅及び銅合金をある応用に供する場合、その応用に必要な特性は、銅に添加される元素の種類とその添加量が適切に選択されることにより初めて実現される。従って、銅や銅合金の金属AM造形体の生産性や品質改善のために、言い換えると、銅や銅合金の原料粉末のレーザー吸収の改善のために、最適化された組成の銅や銅合金にレーザー吸収率の高い各種異元素を添加したり、その添加量を増加させたりするなどの単純なアプローチは、各種応用に必要な銅合金の性能を悪化させる可能性がある。従って、各種応用に必要な銅合金の性能を十分に確保することが可能な材料組成を維持しながら、レーザー吸収特性が改善された金属AM用銅合金粉末を実現することが求められてきた。

[0009] 粉末のレーザー吸収特性の改善のための一つの重要なアプローチは、粉末を構成する各粒子表面の表面改質により各粒子のレーザー吸収能を改善することである。この表面改質のためには、所望の銅合金組成を有する粉末の各粒子の表面に、金属AMで使用するレーザー波長に対し高い吸収率を示す物質のコーティングを施すことが考えられる。このような粒子表面のコーティングのアプローチとして、所望のコーティング材料を湿式や気相プロセスを

用いて粒子表面に形成することがあり得る。しかしながら、このようなコーティングプロセスでは、各粒子でのコーティング層の厚みの制御だけではなく、粉末全体でのコーティング厚みやコーティング材料の均質性の再現性の問題が付きまとい、結果として造形体の生産性や品質において数々の課題が発生することになる。

[0010] また、銅合金においては、過去の様々な研究開発の結果、高い導電性を維持しながら高い機械強度を実現した材料や、耐熱性に優れる材料などが既に開発されており、金属AMにおいても、既存のこのような高性能銅合金材料を用いて所望の形状を有する金属AM部品を実現したい社会的要請がある。

しかし、コーティングにより形成した材料中の成分の量を制御しながら、最終造形物の銅合金の材料組成を制御することは、大きな製造工程の負荷となるだけでなく、組成ばらつきや微細構造のばらつきに起因する造形部品の性能の悪化、部品の量産性の悪化、また部品の品質の維持の面など、多数の大きな問題を抱える懸念があった。

[0011] また、金属AM造形体の構造欠陥の原因となる一つの因子として、ガスなどの巻き込みに起因するボイドの発生がある。従来の銅合金粉末を用いてPBF法で積層造形した場合、粉末溶融時に、銅合金粉末に内包される不純物が原因となりガスが発生し、溶融した銅合金や凝固した銅合金がガス成分をトラップし、作製された積層造形物の内部にボイドが生じることがあり、安定して高品質な積層造形物を作製することができないおそれがあった。

[0012] また、原料の粉末床にレーザー光や電子線を照射して積層造形する場合、レーザー光などが照射される各場所の粉末粒子の組成再現性を含む原料粉末に関わる微細構造の再現性が欠如している場合、粉末の溶融挙動が不均一となり、その結果、造形体内部にボイドなどの構造欠陥の発生を誘発したり、造形体の金属組成の不均一性による機械特性の悪化を生じさせたりするおそれがあった。

[0013] また、このような原料粉末の微細構造の再現性は、粉末の材料組成の再現性を含み、バインダジェット法など他の金属AMの工法においても同様な問

題となっていた。銅合金の金属AMにおいては、このような各種の原料の課題のため生産性の改善が大きな課題であった。

[0014] この発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ボイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造可能な金属AM用銅合金粉末、および、積層造形物の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0015] 本発明者らは、以上のような観点から、実応用に必要な銅合金組成を有しながらも、金属AMプロセスを用いて高性能で高品質な銅合金部品を高い生産性で実現するための銅合金粉末を製造するための研究開発を行った。その結果、高純度の銅合金を原料として用いて粉末化処理を行った場合、銅合金粉末全体としては不純物が少なくかつ均一な組成を維持しながら、銅合金粉末中の個別の粒子表面に着目すると、レーザーが照射されることになる銅合金粒子表面に薄層が形成されていることが見出された。更に、この銅合金粒子表面に形成された薄層においては、バルクの銅合金粒子内部と比較し、銅よりも高いレーザー吸収を示す粉末構成元素が高頻度で存在するという特徴ある構造が、粉末への個別のコーティングプロセスや付加的なプロセスを経ることなく、銅合金原料からの直接的な粉末化プロセスにおいて自発的に生成することが見出された。

[0016] このような銅合金粒子表面の構造的特徴に加えて、高純度の銅合金原料に由来した銅合金粉末であることにより、ガス成分につながる不純物が少ないことで溶融時のガス発生を抑制することにより、高い熱的、電気的、機械的特性を有しながら、緻密な銅合金造形体を実現し、更にこのような高い性能を示す銅合金造形体の高い生産性と高い品質を実現することが可能な金属AM用銅合金粉末が製造できることを見出した。

[0017] 具体的には、不純物量を十分に低減させ均一な組成を有しながらCrを含有する銅合金鋳塊から作製した銅合金粉末においては、銅合金粉末を構成する各粒子の表面にCrを含む析出物を銅結晶粒界及び銅結晶粒の上（銅結晶

粒の表面)に形成可能であり、このような表面の微細構造を有する金属AM用銅合金粉末を用いて積層造形した場合には、ポイド等の構造欠陥の発生を抑制した緻密な銅合金造形体を製造可能であるとの知見を得た。

[0018] 本発明は、上述の知見に基づいてなされたものであって、本発明の態様1の金属AM用銅合金粉末は、金属AMに用いられる金属AM用銅合金粉末であって、Crを含有する銅合金からなり、銅合金粉末を構成する銅合金粒子の表面にCr含有化合物を有するCr化合物層が形成されていることを特徴としている。

[0019] 本発明の態様1の金属AM用銅合金粉末によれば、Crを含有する銅合金からなり、銅合金粉末を構成する粒子表面の銅結晶粒界および銅結晶粒の上(銅結晶粒の表面)にCr含有化合物を有するCr化合物層が形成されているので、銅合金粉末を構成する粒子表面においてレーザー吸収が効率良く行われることになり、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0020] 本発明の態様2は、態様1の金属AM用銅合金粉末において、前記Cr化合物層が、酸素を有することが好ましい。

本発明の態様2の金属AM用銅合金粉末によれば、銅合金粉末を構成する粒子表面に形成された前記Cr化合物層が酸素を含有するので、銅合金粉末を構成する粒子表面においてレーザー吸収がさらに効率良く行われることになり、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0021] 本発明の態様3は、態様1または態様2の金属AM用銅合金粉末において、銅合金粉末を構成する前記銅合金粒子の断面観察において、前記銅合金粒子全体の結晶粒界にCr含有化合物が分布していることが好ましい。

本発明の態様3の金属AM用銅合金粉末によれば、銅合金粉末を構成する前記銅合金粒子全体の結晶粒界にCr含有化合物が分布しているので、導電

性、熱伝導性、強度に優れた積層造形物を製造することが可能となる。

[0022] 本発明の態様4は、態様1から態様3のいずれか一つの金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の50%累積粒子径D50が5 μ m以上120 μ m以下の範囲内とされていることが好ましい。

本発明の態様4の金属AM用銅合金粉末によれば、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の50%累積粒子径D50が5 μ m以上120 μ m以下の範囲内とされているので、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0023] 本発明の態様5は、態様1から態様4のいずれか一つの金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の10%累積粒子径D10が1 μ m以上80 μ m以下の範囲内とされていることが好ましい。

本発明の態様5の金属AM用銅合金粉末によれば、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の10%累積粒子径D10が1 μ m以上80 μ m以下の範囲内とされているので、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0024] 本発明の態様6は、態様1から態様5のいずれか一つの金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の90%累積粒子径D90が10 μ m以上150 μ m以下の範囲内とされていることが好ましい。

本発明の態様6の金属AM用銅合金粉末によれば、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の90%累積粒子径D90が10 μ m以上150 μ m以下の範囲内とされているので、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0025] 本発明の態様7の積層造形物の製造方法は、態様1から態様6のいずれか一つの金属AM用銅合金粉末を準備する準備工程と、前記金属AM用銅合金粉末を含む粉末床を形成する第1工程と、前記粉末床において所定位置の前

記金属AM用銅合金粉末を固化させて造形床を形成する第2工程とを順次繰り返して積層造形物を作製する造形工程と、を備えることが好ましい。

[0026] 本発明の態様7の積層造形物の製造方法によれば、態様1から態様6のいずれか一つの金属AM用銅合金粉末を用いているので、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ボイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0027] 本発明の態様8は、態様7の積層造形物の製造方法において、前記造形工程後に300℃以上純銅の融点以下の温度範囲で熱処理する熱処理工程を備えていることが好ましい。

作製した積層造形物の応用に応じた適切な熱処理を施すことにより、造形された銅合金の微細構造を制御することが可能となり、所望の機械特性や導電特性を実現することが可能となる。本発明の態様8の製造方法の温度範囲で熱処理することで、適切に微細構造が制御された銅合金の造形体が実現される。

発明の効果

[0028] 本発明によれば、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ボイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造可能な金属AM用銅合金粉末、および、積層造形物の製造方法を提供することができる。

図面の簡単な説明

[0029] [図1]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の概略説明図である。

[図2A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子最表面から15分エッチング後の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、二次電子像である。

[図2B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子最表面から15分エッチング後の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、Crマッピング像である。

[図2C]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子

最表面から15分エッチング後の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり（C18000）、Siマッピング像である。

[図2D]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子最表面から15分エッチング後の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり（C18000）、Niマッピング像である。

[図2E]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子最表面から15分エッチング後の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり（C18000）、元素マッピング合成像である。

[図3A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の表面のオージェ電子分光分析結果を示す図であり（C18150）、最表面から15分エッチング後の粒子表面の二次電子像である。

[図3B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の表面のオージェ電子分光分析結果を示す図であり（C18150）、粒子表面の元素マッピング合成像である。

[図3C]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の表面のオージェ電子分光分析結果を示す図であり（C18150）、最表面から30分エッチング後の粒子表面の半定量分析の結果である。

[図4A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末（C18000）の粒子表面のオージェ電子分光分析による強度デプスプロファイルの一例である。

[図4B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末（C18150）の粒子表面のオージェ電子分光分析による強度デプスプロファイルの一例である。

[図5A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末（C18000）の粒子断面に対するオージェ電子分光分析結果であり、二次電子像である。

[図5B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末（C18000）の粒子断面に対するオージェ電子分光分析結果であり、Crの元素マッピング像である。

[図6A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末（C18150）の粒子断面に対する走査型電子顕微鏡分析結果であり、二次電子像である。

[図6B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末(C18150)の粒子断面に対する走査型電子顕微鏡分析結果であり、Crの元素マッピング像である。

[図6C]本実施形態である金属AM用銅合金粉末(C18150)の粒子断面に対する走査型電子顕微鏡分析結果であり、Zrの元素マッピング像である。

[図7]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の製造方法のフロー図である。

[図8]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を製造する際に用いられる連続鋳造装置の概略説明図である。

[図9]本実施形態である積層造形物の製造方法のフロー図である。

[図10]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を製造する際に用いられる他の連続鋳造装置の概略説明図である。

[図11]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の粒子表面の高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡法(High-Angle Annular Dark Field Scanning Transmission Electron Microscopy, HAADF-STEM)による分析結果の一例であって、(A)はHAADF像、(B)はCuマッピング、(C)はSiマッピング、(D)はCrマッピングを示す。

[図12]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の粒子表面の透過型電子顕微鏡による電子回折分析の結果であり、(A)は明視野像、(B)はCu部の電子回折パターン(Cu[1-10])、(C)はCrSi系析出物由来のCrSi系化合物の電子回折パターン(Cr₃Si[01-2])を示す。

[図13]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子の粒界析出物の高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡法(High-Angle Annular Dark Field Scanning Transmission Electron Microscopy, HAADF-STEM)による分析結果の一例。(A)HAADF像、(B)Crマッピング、(C)Zrマッピング。(A)において矢印はCr系析出物とZr系析出物を示

す。

[図14]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の粒界部の析出物の透過型電子顕微鏡法による分析結果の一例であって、(A)明視野像、(B)高速フーリエ変換図形((A)の四角い枠の部分の分析結果。 Cr_2Zr (Hexagonal) $[-21-4]$)である。

[図15]本実施形態である金属AM用銅合金粉末の粒界部の析出物の透過型電子顕微鏡法による分析結果の一例であって、(A)明視野像、(B)高速フーリエ変換図形((A)の四角い枠の部分の分析結果。 Cu_8Zr_3 (Orthorhombic) $[21-4]$)である。

[図16A]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、エッチング前の粒子最表面の二次電子像である。

[図16B]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、エッチング前の粒子最表面のCrマッピング像である。矢印は銅結晶粒子上のCr系析出物の存在を示す。

[図16C]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、図16Aに示す粒子最表面から5分間エッチング後の粒子表面のCrマッピング像である。矢印は銅結晶粒子上のCr系析出物の存在を示す。

[図16D]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、図16Aに示す粒子最表面から15分間エッチング後の粒子表面のCrマッピング像である。矢印は銅結晶粒子上のCr系析出物の存在を示す。

[図16E]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり(C18000)、図16Aに示す粒子最表面から30分間エッチング後の粒子表面のCrマッピング像である。

[図16F]本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり（C18000）、図16Aに示す粒子最表面から50分間エッチング後の粒子表面のCrマッピング像である。

発明を実施するための形態

[0030] 以下に、添付した図面を参照して、本発明の一実施形態である金属AM用銅合金粉末について説明する。

本実施形態である金属AM用銅合金粉末は、金属AMに用いられる銅合金粉末である。なお、本実施形態である金属AM用銅合金粉末においては、レーザーを用いたPBF法に特に適したものとされている。

[0031] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50においては、図1に示すように、粒子表面にCr含有化合物を有するCr化合物層52が形成されている。

すなわち、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50においては、図1に示すように、Crを含有する銅合金からなる粒子本体31と、この粒子本体51の外周面（或いは表層）に形成されたCr化合物層52と備えたものとされていることが好ましい。

ここで、本実施形態においては、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子の表面（粒子表面）（或いは表層）は、粒子の最表面から深さ100nmまでの領域を指す。

また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50においては、図4A及び図4Bに示すように、Cr化合物層52は酸素を含有することが好ましい。

[0032] また、金属AM用銅合金粉末の粒子表面のCr化合物層52の厚みは、1nm以上100nm以下となっていることが好ましい。

より詳しくは、Cr化合物層52の厚みは、1nm以上が好ましく、5nm以上であってもよく、10nm以上であってもよく、20nm以上であってもよく、30nm以上であってもよく、50nm以上であってもよい。ま

た、Cr化合物層52の厚みは、100nm以下であることが好ましく、95nm以下であってもよく、90nm以下であってもよく、80nm以下であってもよく、70nm以下であってもよい。

[0033] Cr化合物層52とは、粒子本体51の外周面（或いは表層）に配置されている層であって、Crを含む析出物を含むCr化合物を含有する層であることが好ましい。Cr化合物層52において、Cr化合物は、ドット状の析出物としてCr化合物層52内に一様に又は不均一に分散して含有されている状態であってもよい。Cr化合物層52において、Cr化合物が凝集した複数の不定形のアイランド形状（不定形の凝集体）をなす析出物としてCr化合物層52内に一様に又は不均一に分散して含有されている状態であってもよい。

また、Cr化合物は、粒子本体51の表面の銅結晶粒界に沿って析出しているもよい。

[0034] Cr化合物層52において、Cr化合物が粒子本体51の外周面（或いは表層）を連続的に被覆するように析出している状態であってもよい。このとき、粒子本体51の外周面全面がCr化合物で被覆されていても、外周面（或いは表層）の一部（例えば、外周面の50%以上）を連続的に被覆しているもよい。なお、粒子本体51の外周面（或いは表層）の一部（例えば、外周面の50%以上）を不連続的（或いはアイランド状）に被覆しているもよい。

[0035] Cr化合物層52の厚みは、SiO₂からなる粒子表面をイオンエッチング法で、エッチングレート1.08nm/分でエッチングを行う条件を基準の条件とし、この基準のエッチング条件で、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50の表面をエッチングして、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50の表面を、アルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PHI700xiを用いたオージェ電子分光法によって分析し、Cr化合物を示すCrマッピング像を得て、クロム（Cr）の強度デプスプロファイル（図4A又は図4Bに示す、強度－エッチング時間の関係を示すグラフ）を得て

、クロム（Cr）の強度（cps）が、減少しなくなるまで又は所定の値以下となる時間から算出できる。

すなわち、クロム（Cr）の強度（cps）が減少しなくなるまで又は所定の値以下となる時間（分）×基準の条件のエッチングレート1.08nm/分＝Cr化合物層52の厚み、として算出できる。

[0036] さらに、本実施形態においては、銅合金粉末を構成する銅合金粒子50の断面観察において、銅合金粒子全体の結晶粒界にCr含有化合物が分布していることが好ましい。ここで、上記銅合金粒子全体は、1つの銅合金粒子において該粒子の表面および内部を指す。

[0037] 図2A～図2Eに示すように、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50の粒子本体51は、多結晶体とされており、粒子本体51の表面には、Crを含む化合物からなるCr含有化合物が分布していることが確認される。なお、このCr含有化合物は、結晶粒界および結晶粒内の両方に分布している。

なお、本実施形態においては、Cr化合物層52に存在するCr系析出物由来のCr含有化合物の粒子表面に沿った直径又は長径が1nm以上1000nm以下の範囲内とされていることが好ましい。Cr含有化合物の粒子表面に沿った直径又は長径は、800nm以下であってもよく、500nm以下であってもよく、300nm以下であってもよく、100nm以下であってもよく、80nm以下であってもよい。また、Cr含有化合物の粒子表面に沿った直径又は長径の下限値は、5nm以上であってもよく、10nm以上であってもよく、上限値は90nm以下であってもよく、80nm以下であってもよい。

[0038] ここで、Cr含有化合物の粒子表面に沿った直径又は長径は、Cr含有化合物が粒子本体51の外周面にドット形状又は不定形のアイランド形状（島形状）で分散している場合の、粒子本体51の外周面に沿った、各Cr含有化合物の析出物の凝集体それぞれの直径又は長径であり、粒子本体51の外周面をアルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PH

I 7 0 0 x i を用いたオージェ電子分光法で分析した画像から測定できる。

[0039] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50の粒子本体51の表面に、Cr含有化合物由来の析出物が分散している場合、Cr化合物層52におけるCr含有化合物由来の析出物の密度は、Cr化合物層52の最表面の何れかにおいて、面積率が15%以上である箇所が観察でき、面積率が20%以上である箇所が観察できるとよい。

[0040] Cr化合物層52におけるCr含有化合物由来の析出物の密度は、Cr化合物層52の最表面を、アルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PHI 700xiを用いたオージェ電子分光法で分析した画像を用いて、 $1\mu\text{m}^2$ あたりのCr含有化合物の析出物のサイズ及び個数から、Cr含有化合物（Cr系析出物）の面積占有率を算出して得ることが出来る。

[0041] Cr化合物層52におけるCr含有化合物由来の析出物が粒子本体51の表面の銅結晶粒界に沿って析出している場合、また、粒子本体51の表面をオージェ電子分光法を用いて観察する場合、銅結晶粒界は線として捉えることが出来る。この際、Cr含有化合物由来の析出物の銅結晶粒界単位長さあたりの密度（線密度）を求めることが出来る。

Cr化合物層52の最表面を、アルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PHI 700xiを用いたオージェ電子分光法で分析した画像の銅結晶粒界を観察し、粒界長さ $1\mu\text{m}$ あたりをCr含有化合物由来の析出物が占める割合から、粒界長さ $1\mu\text{m}$ あたり線密度を求めてもよい。この場合、線密度が30%以上である箇所を観察できるとよい。

[0042] また、図5A及び図5B及び図6A～図6Cに示すように、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50においては、粒子の断面を分析した結果、粒子本体51の内部の結晶粒界にCrを含む化合物からなるCr含有化合物が分布している。

なお、本実施形態においては、断面観察の結果、粒子本体51の結晶粒界に観察されるCr含有化合物の直径又は長径が 1nm 以上 1000nm 以下の範囲内とされていることが好ましい。

[0043] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、合金元素として、Crを0.01質量%以上10質量%以下の範囲内で含有することが好ましい。

なお、Crの含有量の下限は0.1質量%以上であることがさらに好ましく、0.5質量%以上であることがより好ましい。Crの含有量の上限は3質量%以下であることがさらに好ましく、1.5質量%以下であることがより好ましい。

さらに、本実施形態においては、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、Cr以外の合金元素を含有していてもよい。例えば、銅合金は、Cr以外の合金元素としてSi及びNiを含有してもよい。このとき、図2A～図2Eに示すように、粒子本体51の表面にCr含有化合物が分布していることが好ましい。また、図5A及び図5Bに示すように、粒子の断面観察において、結晶粒界にCr含有化合物が分布していることが好ましい。

なお、Cr、Si、Niを含有する銅合金としては、Crを0.1質量%以上0.8質量%以下の範囲内、Siを0.4質量%以上0.8質量%以下の範囲内、Niを1.8質量%以上3.0質量%以下の範囲内で含み、残部が銅及び不純物からなる組成（いわゆるC18000に相当する組成）のものが挙げられる。

なお、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金の組成において、数字の精度の誤差は±10%である（O、H、S、及びNを除く）。

[0044] Cr、Si、及びNiを含有する銅合金においては、CrSi系化合物及びNiSi系化合物が含有されていることが好ましい。これらのうち、Cr含有化合物であるCrSi系化合物として、具体的にはCr₃Siなどが挙げられる。また、NiSi系化合物として具体的にはNi₅Si₂などが挙げられる。

また、Cr、Si、及びNiを含有する銅合金は、CrSi系化合物及び

NiSi系化合物以外に、CrとSiとNiを含有する銅合金及び該銅合金の酸化物を含有してよい。酸化物は、本実施形態の金属AM用銅合金粉末が酸素含有雰囲気や水分含有雰囲気などに曝された際に形成されることがある。

[0045] また、例えば、Cr以外に、合金元素としてZrを含有した銅合金で構成されていてもよい。このような銅合金は、Zrを0.01質量%以上10質量%以下の範囲内で含有することが好ましい。このとき、図3A～図3Cに示すように、粒子本体51の表面にZr含有化合物が分布していることが好ましい。また、図6A～図6Cに示すように、粒子の断面観察において、結晶粒界にZr含有化合物が分布していることが好ましい。

なお、CrとZrを含有する銅合金としては、例えば、Crを0.5質量%以上1.5質量%以下の範囲内、Zrを0.02質量%以上0.2質量%以下の範囲内、残部が銅及び不純物からなる組成（いわゆるC18150に相当する組成）のものが挙げられる。

[0046] CrとZrを含有する銅合金において含有されるCr含有化合物としては、具体的にはCr₂Zrが挙げられる。また、Cr化合物層52においては、Crが単体で存在していてもよい。

また、Cr化合物層52は、粒子本体51を構成する元素の酸化物を有していてもよい。

また、CrとZrを含有する銅合金は、Zr含有化合物を有していてもよく、Zr含有化合物として具体的には、Cu₈Zr₃が挙げられる。

[0047] 本実施形態において、合金元素とは、Cr、Si、Ni、Zrをいう。なお、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、合金元素として、Cr、Si、Ni、Zrの1種又は2種を含む。また、本実施形態において不純物とは、後述する不純物元素とO、H、S、及びNを含む成分である。

[0048] また、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、合金元素以外の添加元素および不純物元素（O、H、S、及びNを除く）を含ん

でいてもよい。

本実施形態において添加元素とは、本実施形態の金属AM用銅合金粉末に意図的に添加される元素である。一方、不純物元素（O、H、S、及びNを除く）とは、本実施形態の金属AM用銅合金粉末に意図せずに混入するものであり、製造工程中のコンタミネーションや原料に微量に含有される不純物に由来する。不純物元素は不可避不純物であってもよい。

金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する合金元素以外の添加元素および不純物元素（O、H、S、及びNを除く）としては、例えば、Mg、Ti、Al、Zn、Ca、Sn、Pb、Fe、Mn、Te、Nb、P、Co、Sb、Bi、Ag、Ta、W、Mo等を挙げることができる。なお、合金以外の添加元素および不純物元素は、Mg、Ti、Al、Zn、Ca、Sn、Pb、Fe、Mn、Te、Nb、P、Co、Sb、Bi、Ag、Ta、W、及びMo等の群から選択される少なくとも一種の元素を含んでいてもよい。

ここで、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する合金元素以外の添加元素および不純物元素（O、H、S、及びNを除く）は、総量で0.07mass%以下であってもよく、0.06mass%以下であってもよく、0.05mass%以下であってもよく、0.04mass%以下とすることが好ましく、0.03mass%以下とすることがさらに好ましく、0.02mass%以下とすることがより好ましく、さらには0.01mass%以下とすることが好ましい。

また、金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する合金元素以外の添加元素および不純物元素（O、H、S、及びNを除く）のそれぞれの含有量の上限は、30massppm以下とすることが好ましく、20massppm以下とすることがさらに好ましく、15massppm以下とすることがより好ましい。

[0049] なお、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、Crを0.01質量%以上10質量%以下の範囲内で含有し、

残部が銅及び不純物からなる組成でもよい。また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子50を構成する銅合金は、Crを0.01質量%以上10質量%以下の範囲内で含有し、残部が銅、上記の添加元素及び不純物元素からなる組成でもよい。

[0050] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末においては、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の50%累積粒子径D50が5 μ m以上120 μ m以下の範囲内、10%累積粒子径D10が1 μ m以上80 μ m以下の範囲内、90%累積粒子径D90が10 μ m以上150 μ m以下の範囲内とされていることが好ましい。

[0051] なお、50%累積粒子径D50の下限は10 μ m以上であることがさらに好ましく、15 μ m以上であることがより好ましい。50%累積粒子径D50の上限は100 μ m以下であることがさらに好ましく、90 μ m以下であることがより好ましい。

また、10%累積粒子径D10の下限は5 μ m以上であることがさらに好ましく、10 μ m以上であることがより好ましい。10%累積粒子径D10の上限は70 μ m以下であることがさらに好ましく、60 μ m以下であることがより好ましい。

さらに、90%累積粒子径D90の下限は20 μ m以上であることがさらに好ましく、30 μ m以上であることがより好ましい。90%累積粒子径D90の上限は140 μ m以下であることがさらに好ましく、120 μ m以下であることがより好ましい。

[0052] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末の製造方法の一例について、図7のフロー図を用いて説明する。なお、本実施形態では、レーザーPBF法に適した銅合金粉末を製造するものである。

本実施形態である金属AM用銅合金粉末の製造方法は、銅合金鋳塊を得る溶解・鋳造工程S01と、得られた銅合金鋳塊を線棒材に加工して銅合金原料とする銅合金原料作製工程S02と、銅合金原料を粉末に加工する粉末加工工程S03と、を備えている。

[0053] (溶解・鋳造工程 S 0 1)

まず、所定組成の銅合金鋳塊を製造する。溶解・鋳造工程 S 0 1 においては、溶解工程、合金元素添加工程、連続鋳造工程を有している。ここで、本実施形態においては、図 8 に示す連続鋳造装置 1 0 を用いて銅合金鋳塊 1 を製造する。

この連続鋳造装置 1 0 は、溶解炉 1 1 と、溶解炉 1 1 の下流に配置されたタンディッシュ 1 2 と、溶解炉 1 1 とタンディッシュ 1 2 とをつなぐ連結樋 1 3 と、タンディッシュ 1 2 において合金元素を添加する添加部 1 4 と、タンディッシュ 1 2 の下流側に配設された連続鋳造用鋳型 1 5 と、タンディッシュ 1 2 から連続鋳造用鋳型 1 5 へと銅合金溶湯を注入する注湯ノズル 1 6 と、を備えている。

[0054] 銅溶湯供給部の溶解炉 1 1 においては、非酸化性雰囲気（不活性ガス雰囲気または還元性雰囲気）で、銅原料を溶解して銅溶湯 3 を得る（溶解工程）。

ここで、溶解炉 1 1 において溶解する銅原料は、銅の純度が 99.99 mass % 以上の高純度銅（例、高純度の電気銅や無酸素銅）とされている。なお、溶解する銅原料は、4 N グレード（99.99 mass %）以上の高純度銅であるが、5 N グレード（99.999 mass %）以上の高純度銅であることがさらに好ましく、6 N（99.9999 mass %）以上の高純度銅であることがより好ましい。また、得られる銅溶湯 3 は無酸素銅溶湯であることが好ましい。

[0055] 連結樋 1 3 においては、得られた銅溶湯 3 を、非酸化性雰囲気（不活性ガス雰囲気または還元性雰囲気）を維持した状態で、タンディッシュ 1 2 に供給する。連結樋 1 3 は溶解炉 1 1 とタンディッシュ 1 2 との間に配置され、銅溶湯 3 は非酸化性雰囲気の連結樋 1 3 内を通過する。

また、タンディッシュ 1 2 内においては、非酸化性雰囲気（不活性ガス雰囲気または還元性雰囲気）にて、銅溶湯 3 を保持する。

なお、溶解炉 1 1、連結樋 1 3、タンディッシュ 1 2 が、非酸化性雰囲気

(不活性ガス雰囲気または還元性雰囲気)とされていることから、銅溶湯3中のガス成分(O, H)が低減されることになる。

[0056] そして、タンディッシュ12においては、銅溶湯3に対して添加部14を用いて合金元素を適宜添加する(合金元素添加工程)。また、ここで添加元素を適宜添加してもよい。

ガス成分(O, H)が十分低減された銅溶湯3に対して合金元素を添加することにより、合金元素の添加歩留が良いので、合金元素の使用量を低減でき、銅合金の製造コストを低減することができる。

また、タンディッシュ12内を流動している銅溶湯3に対して合金元素を添加することにより、合金元素を均一に溶解して、成分値が安定した銅合金溶湯を連続的に製造することができる。

[0057] 得られた銅合金溶湯を、注湯ノズル16を介して連続鑄造鑄型15に注入し、銅合金鑄塊1を連続的に製造する(連続鑄造工程)。

なお、本実施形態では、断面円形の銅合金鑄塊を製造するものとしている。

[0058] ここで、本実施形態では、得られた銅合金鑄塊1においては、O濃度が10 mass ppm以下、H濃度が5 mass ppm以下とされている。

なお、得られた銅合金鑄塊1においては、S濃度が15 mass ppm以下とされていることが好ましい。

さらに、得られた銅合金鑄塊1においては、Cuおよび合金元素以外の添加元素および不純物元素の含有量は合計で0.04 mass %以下であることが好ましい。

[0059] (銅合金原料作製工程S02)

次に、溶解・鑄造工程S01で得られた銅合金鑄塊を線棒材に加工して、銅合金原料を製造する。銅合金原料作製工程S02においては、押出工程と、引抜工程と、切断工程と、を備えている。

この銅合金原料作製工程S02においては、まず、断面円形の銅合金鑄塊を加熱し、熱間押出加工によって、所定の直径の棒材とする(押出工程)。

なお、本実施形態においては、熱間押出加工時の加熱温度を700℃以上1000℃以下の範囲内とすることが好ましい。

[0060] 次に、得られた棒材に対して引抜加工を行って、所定の直径の線材とする（引抜工程）。なお、引抜加工の温度には特に制限はないが、冷間または温間圧延となる−200℃から200℃の範囲内とすることが好ましく、特に常温が好ましい。

[0061] そして、得られた線材を所定の長さに切断し、銅合金原料とする（切断工程）。

ここで、得られた銅合金原料におけるO濃度が10massppm以下、H濃度が5massppm以下であることが好ましい。

また、得られた銅合金原料におけるS濃度が15massppm以下であることが好ましい。

さらに、得られた銅合金原料におけるCuおよび合金元素以外の添加元素および不純物元素（O、H、及びSを除く）の含有量は合計で0.04mass%以下であることが好ましい。

[0062] （粉末加工工程S03）

次に、銅合金原料作製工程S02で得られた銅合金原料を用いて、アトマイズ処理することにより、金属AM用銅合金粉末を製造する。

この粉末加工工程S03においては、溶解工程と、アトマイズ処理工程と、分級工程と、を備えている。

この溶解工程では、銅合金原料を加熱して溶解して合金溶湯を得る。ここで、本実施形態では、溶解時の雰囲気は非酸化雰囲気とすることが好ましい。

アトマイズ処理工程では、例えばガスアトマイズ法によって粉末を得る。すなわち、溶解工程で得られた合金溶湯を、高圧ガス噴霧して合金溶湯の液滴を急冷することで、球状または球状に類似する形状の粉末を製造する。ガスアトマイズ法に用いられるガスとしては、アルゴン、窒素などの不活性ガスを利用可能である。

分級工程では、得られた粉末を分級処理し、所定の粒度分布を有する銅合金粉末を得る。ガスアトマイズ処理における銅合金原料の溶解温度（ガスアトマイズ処理時の温度）は銅の融点以上、1500℃以下であることが好ましい。ガスアトマイズ処理時の溶解温度は、1085℃以上、1500℃以下であってもよい。

[0063] ここで、本実施形態では、上述のように、不純物元素（O, H, S, 及びNを除く）の含有量が十分に低減された銅合金原料由来の合金溶湯を用いてアトマイズ処理していることから、Cr等の合金元素が不純物元素（O, H, S, 及びNを除く）と反応して消費されることが抑制され、Cr含有化合物を生成させることが可能となる。

また、本実施形態では、不純物（不純物元素とO, H, S, 及びNを含む成分）の含有量が十分に低減された銅合金原料由来の合金溶湯を用いてアトマイズ処理していることから、Cr等の合金元素が不純物（不純物元素とO, H, S, 及びNを含む成分）と反応して消費されることが抑制され、Cr含有化合物を生成させることが可能となる。

[0064] 上述の各工程により、本実施形態である金属AM用銅合金粉末が製造される。なお、本実施形態である金属AM用銅合金粉末においては、O濃度が1000massppm以下、H濃度が5massppm以下であることが好ましい。また、S濃度が10massppm以下であることが好ましい。

詳しくは、O濃度は2700massppm以下程度であってもよく、1000massppm以下であると好ましく、900massppm以下であることがより好ましい。また、O濃度の下限値は特に限定されないが、Oを含まない値で（又はOを超える値）あってもよい。

O濃度が高いと造形体に酸素や酸化物などの形で異物が残存し、造形体の各種特性を悪化させる可能性がある。

H濃度は90massppm以下であってもよく、60massppm以下であってもよく、5massppm以下であることが好ましい。また、H濃度の下限値は特に限定されないが、Oを含まない値で（又はOを超える値

) あってよい。

S濃度は、90 mass ppm以下であってもよく、60 mass ppm以下であってもよく、30 mass ppm以下であると好ましい。更に、金属AM用銅合金粉末におけるS濃度が10 mass ppm以下であることがより好ましい。また、S濃度の下限値は特に限定されないが、0を含まない値で（又は0を超える値）あってよい。

また、アトマイズ処理など、有限の圧力下で実施される工程において、大気中もしくは工程中に含まれる雰囲気成分が原因となり、粉末に雰囲気成分が含まれることが生じ得る。例えば、粉末に雰囲気成分に由来する窒素が含まれることが生じ得る。金属AM用銅合金粉末においては、窒素濃度（N濃度）が、30 mass ppmであることが望ましく、20 mass ppmであることがより望ましく、10 mass ppm以下であることが更に望ましい。また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末においては、窒素濃度（N濃度）が、30 mass ppmであることが望ましく、20 mass ppmであることがより望ましく、10 mass ppm以下であってもよく、5 mass ppm以下であることがさらに望ましい。また、N濃度の下限値は特に限定されないが、0を含まない値で（又は0を超える値）あってよい。

[0065] なお、金属AM用銅合金粉末は、合金元素以外の添加元素および不純物元素は、特性に影響を与えない範囲で含有されていてもよい。

ここで、添加元素および不純物元素（O，H，S，及びNを除く）は、総量で0.07 mass %以下であってもよく、0.06 mass %以下であってもよく、0.05 mass %以下であってもよく、0.04 mass %以下とすることが好ましく、0.03 mass %以下とすることがさらに好ましく、0.02 mass %以下とすることがより好ましく、さらには0.01 mass %以下とすることが好ましい。

また、添加元素および不純物元素（O，H，S，及びNを除く）のそれぞれの含有量の上限は、30 mass ppm以下とすることが好ましく、20 mass ppm以下とすることがさらに好ましく、15 mass ppm以下

とすることがより好ましい。

[0066] 次に、本実施形態である積層造形物の製造方法について、図9のフロー図を用いて説明する。

本実施形態である積層造形物の製造方法は、上述の金属AM用銅合金粉末を準備する準備工程S101と、金属AM用銅合金粉末を含む粉末床を形成する第1工程S121と粉末床において所定位置の前記金属AM用銅合金粉末を固化させて造形床を形成する第2工程S122を順次繰り返して積層造形物を作製する造形工程S102と、を備えている。

このような工程により、所定の形状の積層造形物が製造される。この積層造形物においては、本実施形態である金属AM用銅合金粉末を用いていることから、ポイドなどの構造欠陥が少なく、機械的特性に優れている。

[0067] 以上のような構成とされた本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子50によれば、Crを含有する銅合金からなり、粒子本体51の表面にCr含有化合物を有するCr化合物層52が形成されているので、粒子表面においてレーザー吸収が効率良く行われることになり、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0068] 本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子50において、Cr化合物層52が、粒子本体51の銅合金を構成する元素の酸化物を有する場合には、粒子表面においてレーザー吸収がさらに効率良く行われることになり、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0069] また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子50において、粒子本体51を断面観察した際に、結晶粒界にCr含有化合物が分布している場合には、導電性、熱伝導性、強度に優れた積層造形物を製造することが可能となる。

[0070] ここで、本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子50にお

いて、粒子本体51を構成する銅合金がZrを含有しており、粒子本体51の表面にZr含有化合物が分布している場合には、粒子表面においてレーザー吸収がさらに効率良く行われることになり、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0071] また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末を構成する粒子50において、粒子本体51を構成する銅合金がZrを含有しており、粒子本体51を断面観察した際に、結晶粒界にZr含有化合物が分布している場合には、導電性、熱伝導性、強度に優れた積層造形物を製造することが可能となる。

[0072] さらに、本実施形態である金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の50%累積粒子径D50が5 μ m以上120 μ m以下の範囲内とされている場合には、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0073] また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の10%累積粒子径D10が1 μ m以上80 μ m以下の範囲内とされている場合には、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0074] また、本実施形態である金属AM用銅合金粉末において、レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の90%累積粒子径D90が10 μ m以上150 μ m以下の範囲内とされている場合には、金属AMに適した粒度分布を有しており、積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0075] 本実施形態である積層造形物の製造方法においては、本実施形態である金属AM用銅合金粉末を用いているので、金属AMにより作製した造形体の微細構造の再現性が高く、ポイド等の構造欠陥が少ない高品質な積層造形物を安定して製造することが可能となる。

[0076] 以上、本発明の実施形態である金属AM用銅合金粉末、および、積層造形物の製造方法について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、その発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。

例えば、上述の実施形態では、ガスアトマイズ法によって金属AM用銅合金粉末を製造するものとして説明したが、これに限定されることはなく、水アトマイズ法や遠心力アトマイズ法、プラズマアトマイズ法などによって、金属AM用銅合金粉末を製造してもよい。

[0077] また、上述のように得られた金属AM用銅合金粉末に対し、雰囲気制御して適宜熱処理を施して組織の安定化などを図ってもよい。

さらに、本実施形態では、レーザーを用いたPBF法に適した金属AM用銅合金粉末を製造するものとして説明したが、これに限定されることはなく、その他の金属AMに適用する金属AM用銅合金粉末であってもよい。

また、本実施形態では、図8に示す連続鑄造装置を用いて銅合金鑄塊を製造するものとして説明したが、これに限定されることはなく、その他の鑄造装置を用いてもよい。

[0078] 例えば、図10に示す連続鑄造装置101を用いてもよい。この連続鑄造装置101は、最上流部に配置された無酸素銅供給手段（銅溶湯供給部）102と、その下流に配置された加熱炉103と、加熱炉103の下流に配置されて銅溶湯が供給されるタンディッシュ104と、無酸素供給手段102から加熱炉103までをつなぐ溶湯供給路105a、105b、105cと、加熱炉103とタンディッシュ104とをつなぐ樋106と、非酸化性雰囲気中で合金元素を添加する添加手段（添加部）107、108と、連続鑄造鑄型42と、を備えている。なお、無酸素銅供給手段102、加熱炉103、タンディッシュ104、溶湯供給路105a、105b、105cおよび樋106は、それぞれの内部を非酸化性雰囲気としている。

[0079] 無酸素銅供給手段102は、銅原料を溶解する溶解炉121と、溶解炉121で溶解されて得られた溶銅を一時保持する保持炉122と、溶銅中の酸素および水素を除去する脱ガス処理装置124と、これらをつなぐ溶湯供給路105a、105b、105cと、で構成されている。

[0080] 脱ガス処理装置124は、その内部で溶銅が攪拌されるように攪拌手段としてガスバブリング装置を有しており、例えば不活性ガスによるバブリング

等を行うことにより、溶銅から酸素および水素を除去する。

溶湯供給路 105 a、105 b、105 c は、溶銅および無酸素銅溶湯が酸化されるのを防止するために、その内部を非酸化性雰囲気としている。この非酸化性雰囲気は、例えば、窒素と一酸化炭素の混合ガスやアルゴン等の不活性ガスを溶湯供給路内に吹き込むことにより形成される。

[0081] 合金元素を添加する添加手段として、加熱炉 103 に配設された第 1 の添加手段 107 と、タンディッシュ 104 に配設された第 2 の添加手段 108 と、を備えている。

加熱炉 103 に設けられた第 1 の添加手段 107 から合金元素を連続的にまたは間欠的に装入すると、加熱炉 103 内に貯留された無酸素銅溶湯中に合金元素が添加される。ここで、貯留部に貯留された無酸素銅溶湯は、高周波誘導コイルによって加熱され、添加された合金元素の溶解が促進されることになる。

また、タンディッシュ 104 に設けられた第 2 の添加手段 108 から合金元素を連続的にまたは間欠的に装入すると、タンディッシュ 104 内を流れる無酸素銅溶湯中に合金元素が添加される。ここで、タンディッシュ 104 内を流れる無酸素銅溶湯は、加熱炉 103 で加熱されて高温であるとともにタンディッシュ 104 内を流動していることから、添加された合金元素の溶解が促進されることになる。

実施例

[0082] 以下に、本発明の効果を確認すべく行った確認実験の結果について説明する。

[0083] (本発明例)

まず、実施形態に記載した製造方法により、4Nグレードの高純度銅からなる銅原料を用いて、表 1 に示す組成の C18000 と C18150 の鋳塊を作製した（表 1 で示す不純物は不純物から O, H, S を除く。）。

次に、作製した C18000 と C18150 の鋳塊を原料として、アルゴンガスを用いるガスアトマイズ法によって、表 2 に示す組成の金属 AM 用 C

18000粉末及び金属AM用C18150粉末を作製し、レーザーPBFの粉末床に適する粒度に分級した（表2で示す不純物は不純物からO, H, S, Nを除く。）。ガスアトマイズ処理時の溶解温度は1300°Cの条件で行った。

[0084] 本発明例の金属AM用C18000粉末について、マイクロトラック社製MT3300EXIIを用いた粒径分布測定を行った結果、体積基準の10%累積粒子径が15 μ m、50%累積粒子径が27 μ m、90%累積粒子径が45 μ mの粒度分布となった。

本発明例の金属AM用C18150粉末について、マイクロトラック社製MT3300EXIIを用いた粒径分布測定を行った結果、体積基準の10%累積粒子径が19 μ m、50%累積粒子径が30 μ m、90%累積粒子径が49 μ mの粒度分布となった。

そして、本発明例の金属AM用C18000粉末を用い、市販のレーザーPBF装置を用いて、エネルギー密度を13J/mm²の条件で、積層造形物の小片を作製した。また、本発明例の金属AM用C18150粉末を用い、市販のレーザーPBF装置を用いてエネルギー密度を5J/mm²の条件で、積層造形物の小片を作製した。

[0085] (金属AM用銅合金粉末の表面構造)

本発明例の金属AM用C18000粉末並びに金属AM用C18150粉末について、それぞれの粒子表面の微細構造を、オージェ電子分光分析法を用いて評価した。金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の表面のオージェ電子分光分析の結果を図2A~図2E、図3A~図3Cおよび図4A及び図4Bに示す。

[0086] (金属AM用銅合金粉末の断面構造)

本発明例の金属AM用C18000粉末並びに金属AM用C18150粉末について、それぞれの粒子断面の微細構造を、オージェ電子分光分析法及び走査型電子顕微鏡分析法を用いて評価した。金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の断面の分析結果を図5A及び図5B及び図6A~図6Cに示す。

[0087] (鋳塊および金属AM用銅合金粉末の組成)

表1に示す鋳塊、および、表2に示す本発明例の金属AM用銅合金粉末におけるO濃度は不活性ガス融解—赤外線吸収法、H濃度は不活性ガス融解—熱伝導度法、S濃度は燃焼—赤外線吸収法で求めた。また、銅を除き、これらの物質以外の成分の濃度は、蛍光X線分析法、グロー放電質量分析法、誘導結合プラズマ質量分析法を組み合わせで求めた。

[0088] (造形物密度)

作製した積層造形物の断面と、積層造形物の断面において観測されるボイドが占有する面積から、積層造形物の密度を評価した。本明細書においては、この密度を造形物密度と定義する。

造形物密度の評価は、造形物断面において計測対象の断面積を定義した後(これを評価断面積と呼ぶ。3.4mm四方。)、この計測断面積の内部にあるボイド箇所を確認した後、評価断面積におけるボイドの占有面積を算出した。

そして、(評価断面積—ボイド占有面積) / 評価断面積を造形物密度と定義した。造形物密度の評価結果を表2に示す。

[0089] (造形物の機械的特性および電気伝導度の評価)

また、作製した積層造形物に対して、後述の熱処理を行い、熱処理後の積層造形物のビッカース硬度および導電率を測定した。

作製した積層造形物の機械的特性として、室温においてビッカース硬度(HV単位)をJIS Z 2244:2009に準じて測定した。ビッカース硬度の測定荷重は10kgfとした。また、作製した積層造形物の%IACS単位の導電率を過流式導電率測定により室温において計測した。これらの造形物の特性を表2に示す。

[0090] (銅合金粒子の表面におけるCrSi系化合物、NiSi系化合物の有無)

高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡法により、本発明例の金属AM用銅合金粉末において、粉末を構成する銅合金粒子表面におけるCrSi系化合物

、NiSi系化合物の有無を確認した。図11及び図12に示すように分析結果を得た。

[0091] (銅合金粒子の表面におけるCr含有化合物、Zr含有化合物の有無)

高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡法及び透過型電子顕微鏡法により、本発明例の金属AM用銅合金粉末において、粉末を構成する銅合金粒子表面におけるCr含有化合物、Zr含有化合物の有無を確認した。図13～図15に示すように分析結果を得た。

[0092] [表1]

	成分組成(質量比)								
	Cu	Cr (%)	Ni (%)	Si (%)	Zr (%)	O (ppm)	H (ppm)	S (ppm)	不純物 (%)
C18000 鋳塊	残	0.40	2.60	0.50	<0.001	<10	<5	<10	<0.02
C18150 鋳塊	残	0.84	<0.001	<0.002	0.05	<10	<5	<10	<0.04

[0093]

[表2]

	成分組成(質量比)										積層造形物		
	Cu	Cr	Ni	Si	Zr	O	H	S	不純物	密度	ビッカース	導電率	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(%)	(HV)	(%IACS)	
C18000 粉末	残	0.40	2.60	0.50	<0.001	100	<10	<10	<0.02	99.3	194	40	
C18150 粉末	残	0.81	0.0035	<0.002	0.06	120	<10	<10	<0.04	99.6	130	90	

[0094] 図2A～図2E、図3A～図3Cは、本発明の金属AM用銅合金粉末（図2A～図2EがC18000粉末、図3A～図3CがC18150粉末）の粒子表面をイオンエッチングした後のオージェ電子分光分析の結果である。本オージェ電子分光分析の実験系における本発明の銅合金粉末の粒子表面における各構成元素単体や各構成元素により生じる化合物のエッチングレートは定かではないが、本オージェ電子分光分析の実験系におけるSiO₂のエッチングレートは1.08nm/分であることから、15分間のイオンエッチ

ングは概ね15nmの厚みをエッチングした後の構造であると考えられる。図2A、図3Aに示すように、イオンエッチングした後の粒子表面には、多数のアイランド状の微細な構造が出現した。

[0095] さらに、図2A、図2Bと図2E、また、図3Aと図3Bとの比較により、アイランド状の微細構造はCr系析出物に由来することが確認された。

[0096] また、図16A～図16Fには、本発明の金属AM用銅合金粉末(C18000)を構成する銅合金粒子の粒子表面のオージェ電子分光法による分析結果であり、粒子表面をイオンエッチングする前、5分間、15分間、30分間、50分間イオンエッチングした後のCrマッピング像を示した。まず、図16Aおよび図16Bに示すように、イオンエッチング前の粒子最表面において、銅結晶粒界および銅結晶粒の上(銅結晶粒表面)にCr系析出物がアイランド状に分布していることがわかる。図16A及び図16Bにおいて確認されるこのCrの分布は、Cr含有化合物に由来すると考えられる。

図16B～図16Fに示すように、イオンエッチングの時間に伴い、粒子表面のアイランド状の微細組織の構造変化が確認される。図16Fに示すように、50分間のイオンエッチング後もCr系析出物の分布が確認されるが、図16C及び図16Dと比較すると、Crの分布箇所が減少する傾向が確認される。また、本オージェ電子分光分析の実験系におけるSiO₂のエッチングレートと図16B～図16Fのエッチング時間に伴う粒子表面の構造変化の様子から、本発明の金属AM用銅合金粉末(C18000)におけるCr含有化合物を有するCr化合物層52の厚みは、概ね1nmから100nm程度の範囲であると考えられた。

[0097] 一方、図3Cは、本発明の金属AM用銅合金粉末(C18150)の粒子の最表面近傍を30分間イオンエッチングした後の単一の銅結晶粒子の表面のオージェ電子分光分析の結果である。上記のSiO₂のエッチングレートより、30分間のイオンエッチングは概ね30nmの厚みをエッチングした後の構造であると考えられる。図3Cに示すように、30分間イオンエッチングした後、本発明の金属AM用銅合金粉末の粒子表面の銅結晶粒子上にも、

Cu以外にCr、Zrが存在していることが確認される一方、アイランド状の構造が見えにくくなった。

従って、粒子表面に存在するCr系析出物を含む表面層、即ち本発明の金属AM用銅合金粉末（C18150）におけるCr含有化合物を有するCr化合物層52の厚みは概ね1nmから100nm程度の範囲であると考えられた。

[0098] 以上の図16A～図16F及び図3A～図3Cの結果から総合的に考えると、本発明の金属AM用銅合金粉末の粒子表面に存在するCr系析出物を含む表面層、即ちCr含有化合物を有するCr化合物層52の厚みは概ね1nmから100nm程度の範囲であると考えられた。

[0099] また、図4A及び図4Bは、本発明の金属AM用銅合金粉末の粒子表面のオージェ電子分光分析による酸素の強度デプスプロファイルである（図4AがC18000粉末、図4BがC18150粉末）。本発明の金属AM用銅合金粉末においては、銅合金粒子の最表面から銅合金粒子の内部に向かうに従い、含有する酸素の濃度が低くなっていることが確認された。本質的に、本発明の金属AM用銅合金粉末は、銅合金としての酸素を含むため、粒子本体には一定量の酸素が存在し、これが粒子本体の酸素濃度のバックグラウンド濃度を構成するものと考えられる。一方、粒子表面において観測される酸素濃度の勾配は、主として粉末化の工程において生じ、さらに、図4A及び図4Bの結果から概ね1nmから100nm程度の範囲として存在すると考えられ、上記のCr系析出物を含む表面層の厚みのオーダーにおいて酸素濃度の勾配が生じ得ると考えられる。

[0100] 図2A～図2E、図3A～図3C及び図4A及び図4Bに示した結果より、本発明の金属AM用銅合金粉末の粒子表面には銅結晶粒界および銅結晶粒上（銅結晶粒の表面）にCr系析出物由来のCr含有化合物を有するCr化合物層52が形成されており、さらにこのCr化合物層52は酸素を含有する層となっていることが確認された。

すなわち、本発明例の金属AM用銅合金粉末におけるこのような酸素を含

む層の存在は、銅合金粉末の表面変質を抑制する効果を提供するものと考えられる

また、図2A～図2E、図3A～図3C、図4A及び図4Bに示すように、本発明例の金属AM用銅合金粉末は、母相であるCuが主成分であるため、このような酸素は、主として銅酸化物に由来するものと推測され、さらに、合金元素やその他の不純物元素の酸化物の構成元素として存在していると推測される。すなわち、本発明例の金属AM用銅合金粉末の表面におけるCr化合物層は、Crを含有する化合物を内包しながら、Cuや銅酸化物、Crを含む合金元素などの酸化物などから構成される複合層を形成しているものと推測される。

[0101] 本発明例の金属AM用銅合金粉末（C18000粉末及びC18150粉末）の粒子のCr化合物層52におけるCr含有化合物由来の析出物の密度は、Cr化合物層52の最表面を、アルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PHI700xiを用いたオージェ電子分光法で分析した画像を用いて、 $1\mu\text{m}^2$ あたりのCr含有化合物の析出物のサイズ及び個数から、Cr含有化合物（Cr系析出物）の面積占有率を算出して得た。

金属AM用銅合金粉末（C18000粉末）のCr化合物層52の最表面では、析出物の密度が面積率17%である箇所と、面積率21%である箇所が観察され（図2A及び図2B参照）、金属AM用銅合金粉末（C18000粉末）のCr化合物層52の最表面では、析出物の密度が面積率16%である箇所と、面積率28%である箇所が観察された。

[0102] また、本発明例の金属AM用銅合金粉末（C18000粉末及びC18150粉末）の粒子のCr化合物層52のアルバック・ファイ株式会社製走査型オージェ電子分光分析装置PHI700xiを用いたオージェ電子分光法で分析した画像の銅結晶粒界を観察し、粒界長さ $1\mu\text{m}$ あたりをCr含有化合物由来の析出物が占める割合から、粒界長さ $1\mu\text{m}$ あたり線密度を求めた。金属AM用銅合金粉末（C18000粉末）のCr化合物層52では、析出物の銅結晶粒界における線密度が31%である箇所と、60%である箇所が

観察された。金属AM用銅合金粉末（C18150粉末）のCr化合物層52では、析出物の銅結晶粒界における線密度が59%である箇所と、74%である箇所が観察された。

[0103] また、図5A及び図5B及び図6A～図6Cに示すように、銅合金粒子の断面観察として本発明例の金属AM用銅合金粉末を構成する粒子の内部においては、共通して銅結晶粒界にCr含有化合物の析出が確認された（図4A及び図5BがC18000粉末、図6A～図6CがC18150粉末）。また、粒子表面と比較すると、粒子の内部においては、粒界に見られるような頻度でCr含有化合物の析出は見られなかった。すなわち、粒子表面においては、Cr含有化合物が高頻度で観測されることを示している。これは、銅結晶粒内においてCr系析出物がほぼ存在しない、或いは銅結晶粒の内部におけるCr系析出物が、非常に小さく（又は量が少なく）観察しにくい、の何れかであると予測された。一方、図2B～図2Eと図5A～図5Bの比較から、すなわち、粒子表面と粒子断面の比較から、粒子のある面を析出物が占める割合は粒子最表面（或いは表層）の方が粒子内部よりも大きくなると考えられた。

[0104] また、図5A～図5Bにより代表的に示されるように、金属AM用銅合金粉末の粒子の内部の粒界にはCrSi系析出物およびNiSi系析出物の何れか一方又は両方の存在が確認された。この結果は、金属AM用銅合金粉末の粒子の粒子表面のCr化合物層より内部においては、粒界にCrSi系析出物およびNiSi系析出物の何れか一方又は両方が存在していることを示している。

[0105] 一方、図6A～図6Bにより代表的に明示されるように、金属AM用銅合金粉末の粒子の粒子内部の粒界にはCr系析出物の存在が確認された。この結果は、金属AM用銅合金粉末の粒子の粒子表面のCr化合物層より内部においては、粒界にCr系析出物が存在していることを示している。

この結果は、金属AM用銅合金粉末の粒子の粒子表面のCr化合物層より内部においては、表面から内部の粒界においてCr系析出物が存在している

ことを示している。

[0106] 図11で示すように、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子表面の高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡法による分析結果より、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子の表面において形成されているCrSi系化合物は、 Cr_3Si を含むことが確認された。また、図12に示すように、電子回折パターンの解析から、図10の場合においては、 Cr_3Si はCu結晶に格子整合して形成されてしていることが確認された。

[0107] 図13と図14で示すように、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子表面の透過型電子顕微鏡による分析結果より、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子の表面において形成されているCr系化合物は、Cr及び Cr_2Zr (Hexagonal) $[-21-4]$) を含むことが確認された。

[0108] 図15で示すように、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子表面の透過型電子顕微鏡による分析結果より、本発明の金属AM用銅合金粉末の銅合金粒子の表面において形成されているZr系化合物は、 Cu_8Zr_3 (Orthorhombic) $[21-4]$) を含むことが確認された。

[0109] そして、表2に示すように、粒子表面にCr含有化合物が形成された本発明例のC18000組成の金属AM用銅合金粉末を用いて造形した場合、造形物密度は99.3%となった。この結果より、本発明の金属AM用銅合金粉末においては十分なレーザー吸収が促進され、その結果造形体の高密度化が実現されたものと考えられる。

さらに、C18000組成の積層造形物を第一熱処理として $950^{\circ}C-15$ 分間、第二熱処理として $420^{\circ}C-2.2$ 時間の熱処理を施すことにより、熱処理済みの造形体を作製した。この熱処理済み造形体は、室温でビッカース硬度194HV、40% IACSの導電率を示した(表2参照)。

そして、表2に示すように、粒子表面にCr含有化合物が形成された本発明例のC18150組成の金属AM用銅合金粉末を用いて造形した場合、造形物密度は99.6%となった。この結果より、本発明の金属AM用銅合金

粉末においては十分なレーザー吸収が促進され、その結果造形体の高密度化が実現されたものと考えられる。

さらに、C 1 8 1 5 0 組成の積層造形物を第一熱処理として 9 8 0 ° C - 1 5 分間、第二熱処理として 4 5 0 ° C - 1 . 0 時間の熱処理を施すことにより、熱処理済みの造形体を作製した。この熱処理済み造形体は、室温でビッカース硬度 (1 3 0 H V 、 9 0 % I A C S の導電率を示した (表 2)) 。

これらの結果から、本発明例の金属 AM 用銅合金粉末においては、実使用に重要となるボイドの少ない積層造形物を製造可能であり、また実使用に十分な機械的特性と導電性を有することが確認され、実用性のある銅合金積層造形物が実現できることが確認された。

符号の説明

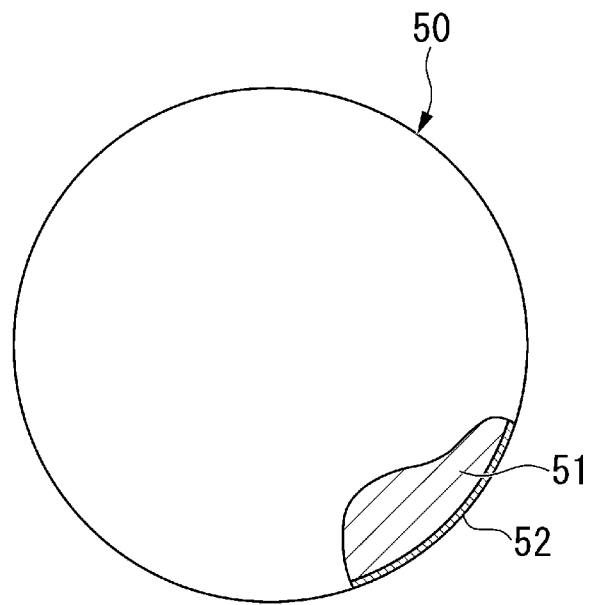
- [0110] 5 0 金属 AM 用銅合金粉末を構成する銅合金粒子
- 5 1 粒子本体
- 5 2 C r 化合物層

請求の範囲

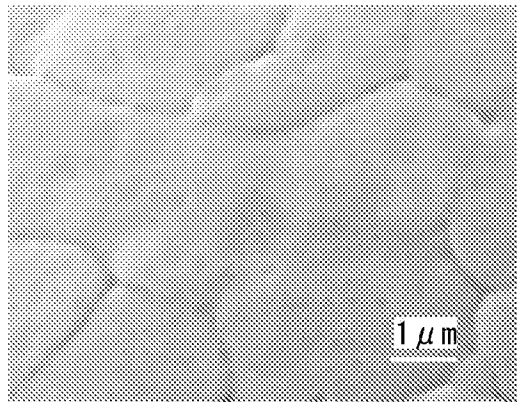
- [請求項1] 金属AMに用いられる金属AM用銅合金粉末であって、
Crを含有する銅合金からなり、銅合金粉末を構成する銅合金粒子の表面にCr含有化合物を有するCr化合物層が形成されていることを特徴とする金属AM用銅合金粉末。
- [請求項2] 前記銅合金粒子の表面の前記Cr化合物層が酸素を有することを特徴とする請求項1に記載の金属AM用銅合金粉末。
- [請求項3] 銅合金粉末を構成する前記銅合金粒子の断面観察において、前記銅合金粒子全体の結晶粒界にCr含有化合物が分布していることを特徴とする請求項1に記載の金属AM用銅合金粉末。
- [請求項4] レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の50%累積粒子径D50が5 μ m以上120 μ m以下の範囲内とされていることを特徴とする請求項1に記載の金属AM用銅合金粉末。
- [請求項5] レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の10%累積粒子径D10が1 μ m以上80 μ m以下の範囲内とされていることを特徴とする請求項1に記載の金属AM用銅合金粉末。
- [請求項6] レーザー回折・散乱法にて測定された体積基準の90%累積粒子径D90が10 μ m以上150 μ m以下の範囲内とされていることを特徴とする請求項1に記載の金属AM用銅合金粉末。
- [請求項7] 請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の金属AM用銅合金粉末を準備する準備工程と、
前記金属AM用銅合金粉末を含む粉末床を形成する第1工程と前記粉末床において所定位置の前記金属AM用銅合金粉末を固化させて造形床を形成する第2工程とを順次繰り返して積層造形物を作製する造形工程と、
を備えることを特徴とする積層造形物の製造方法。
- [請求項8] 前記造形工程後に300 $^{\circ}$ C以上純銅の融点以下の温度範囲で熱処理する熱処理工程を備えていることを特徴とする請求項7に記載の積層

造形物の製造方法。

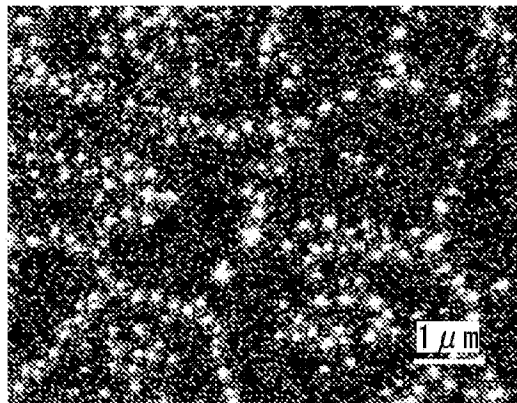
[図1]



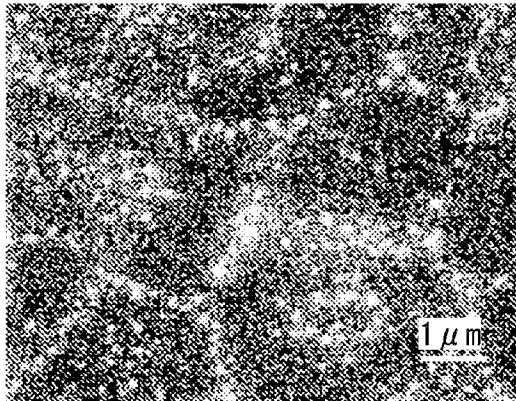
[図2A]



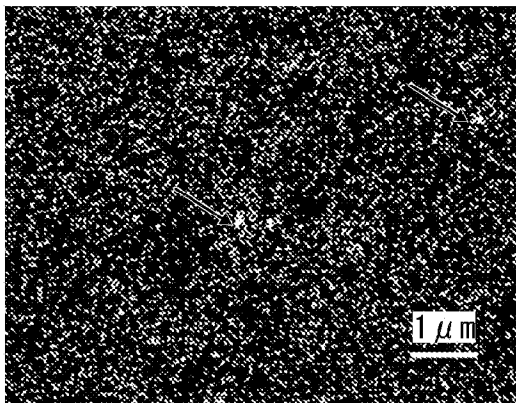
[図2B]



[図2C]

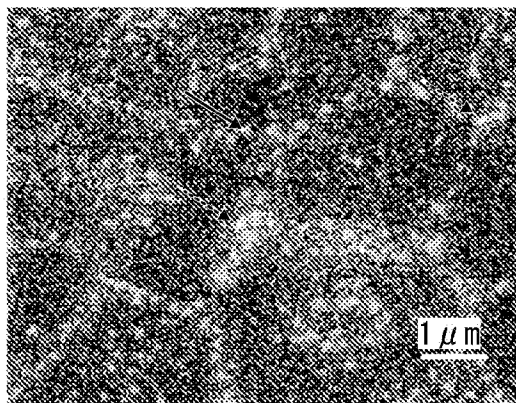


[図2D]



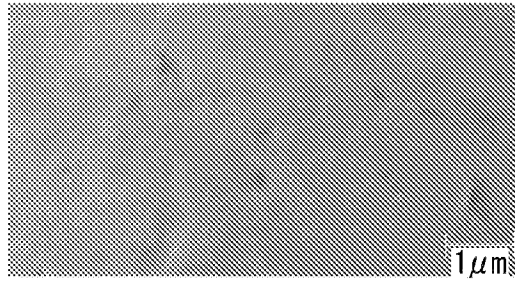
← Ni 位置

[図2E]

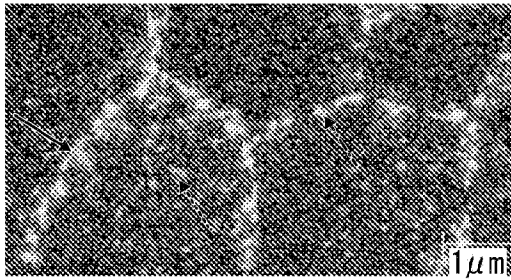


←····· NiSi系化合物
← CrSi系化合物

[図3A]

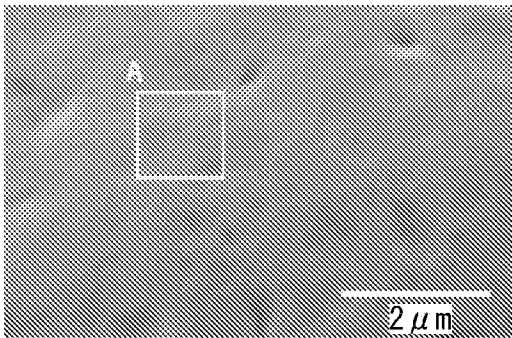


[図3B]



← Zr系析出物
 ←--- Cr系析出物(銅結晶粒界)
 ←----- Cr系析出物(銅結晶粒上)

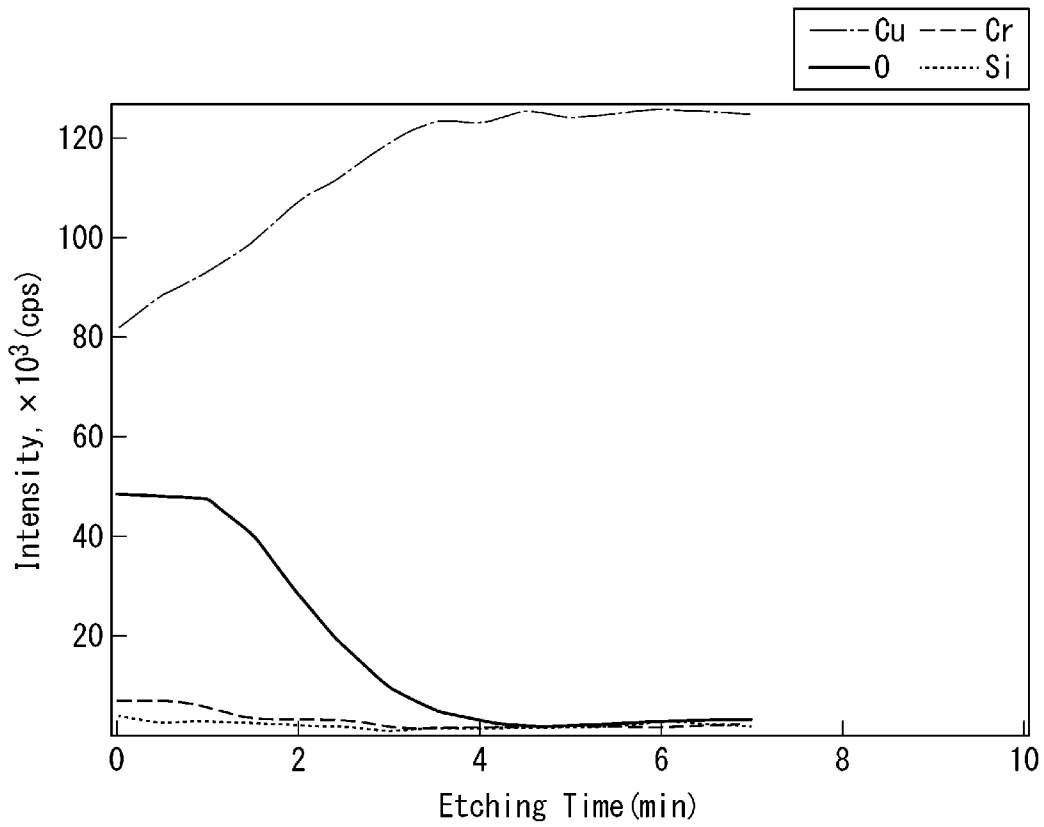
[図3C]



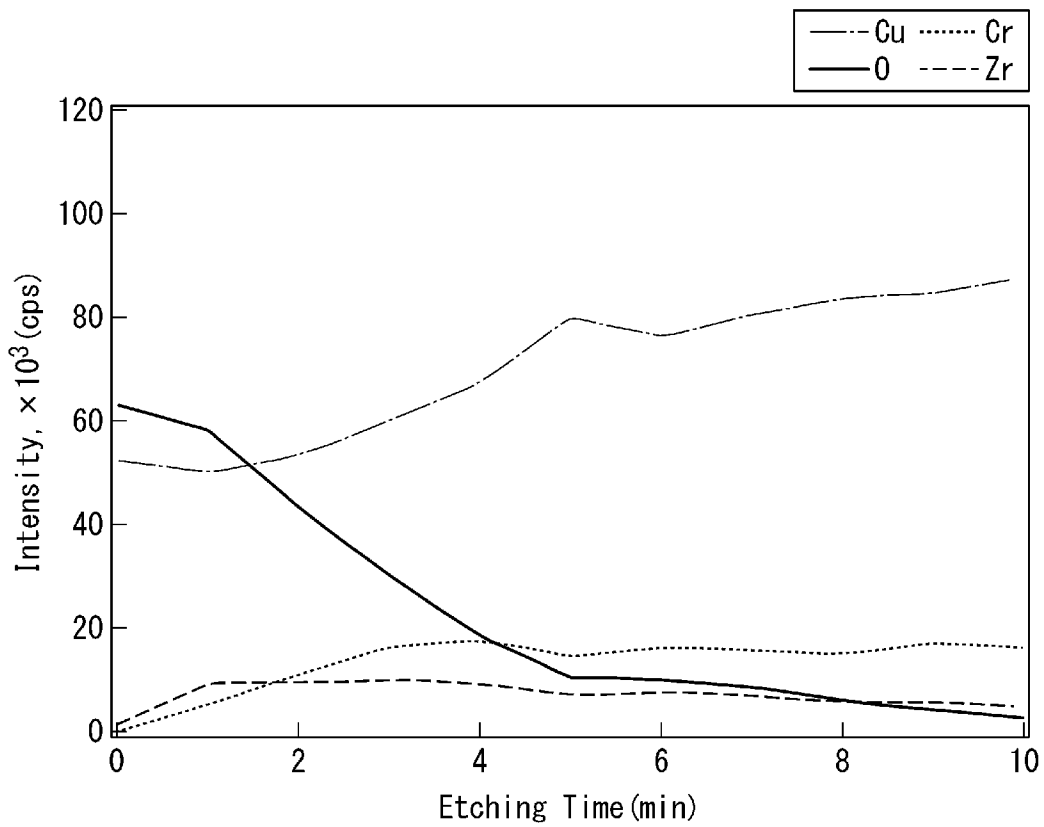
A部の半定量分析結果

O (at%)	Cr (at%)	Cu (at%)	Zr (at%)	Total (at%)
0.02	8.9	90.75	0.33	100

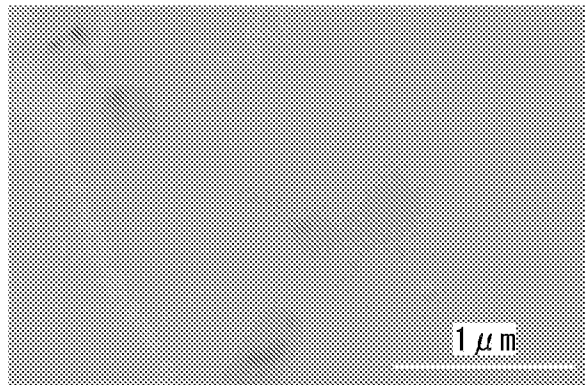
[図4A]



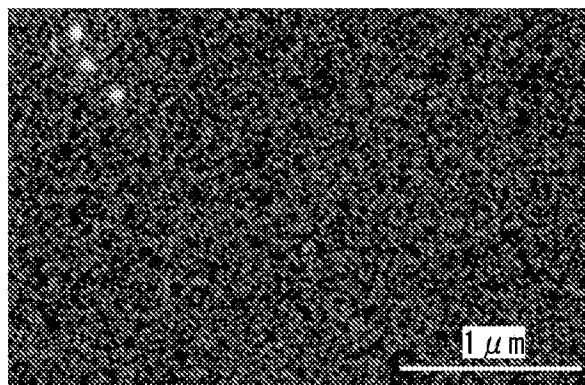
[図4B]



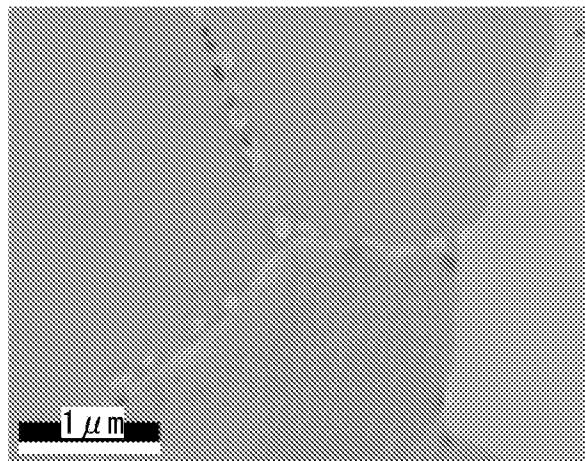
[図5A]



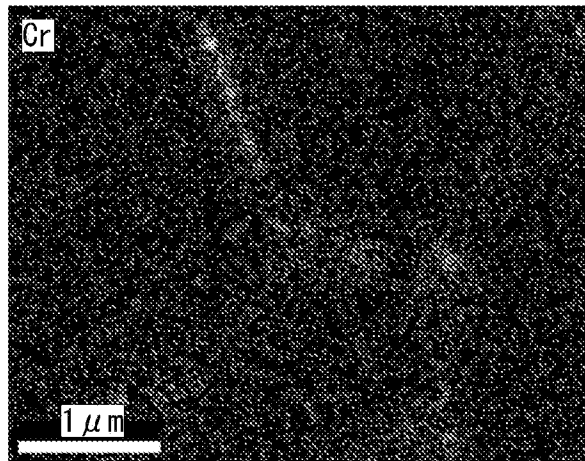
[図5B]



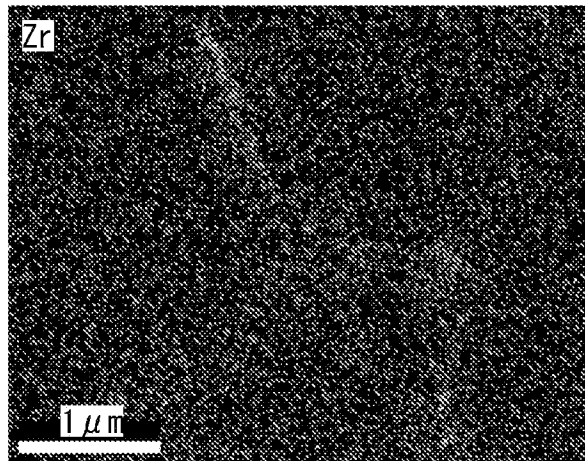
[図6A]



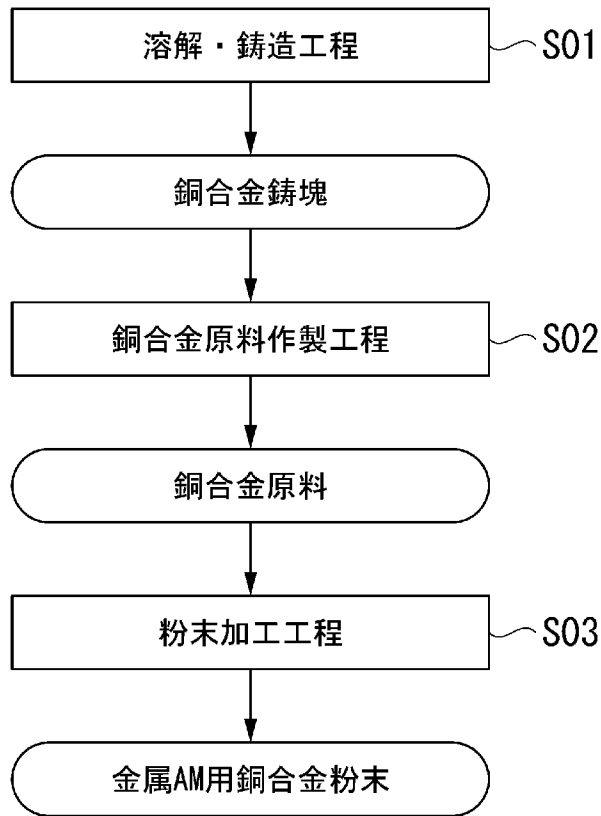
[図6B]



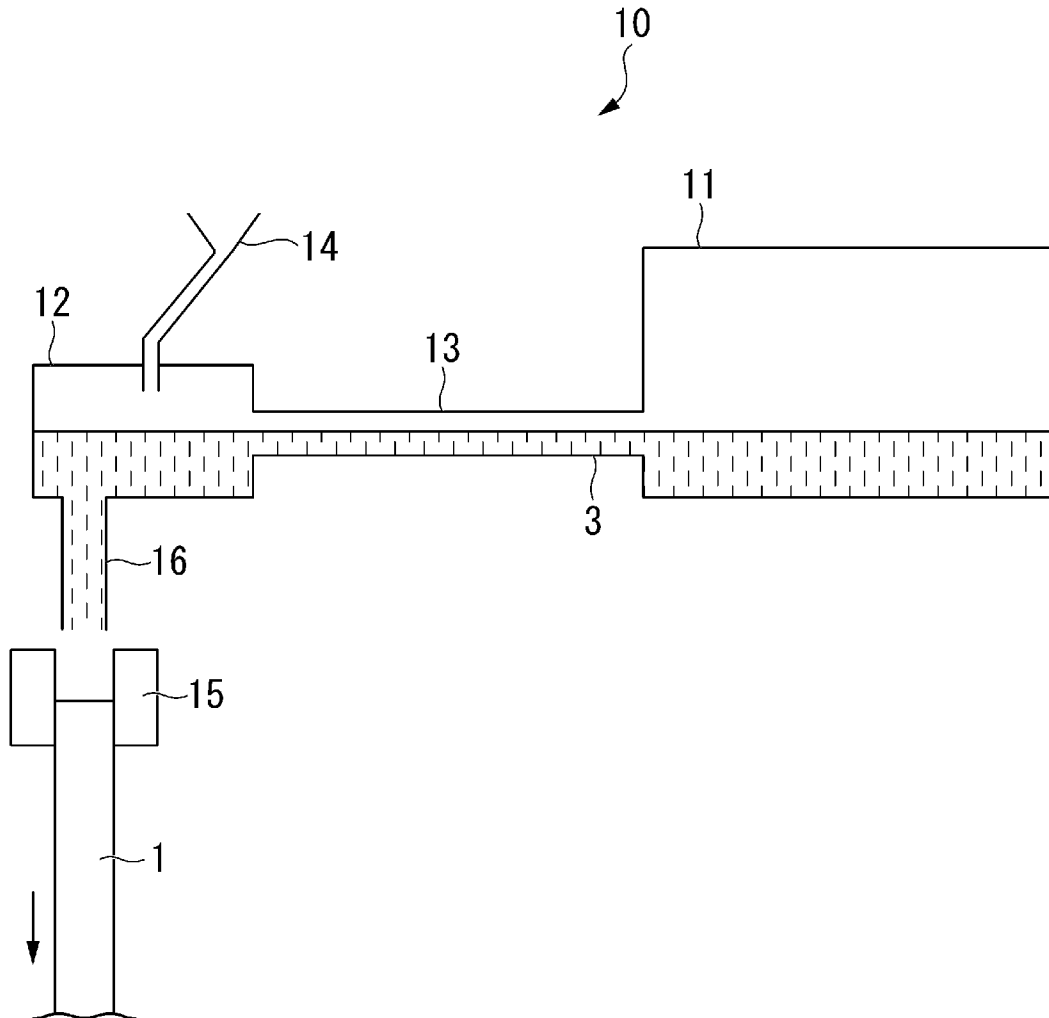
[図6C]



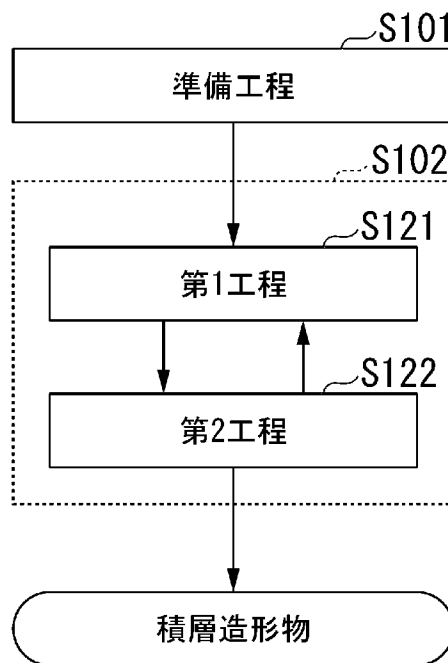
[図7]



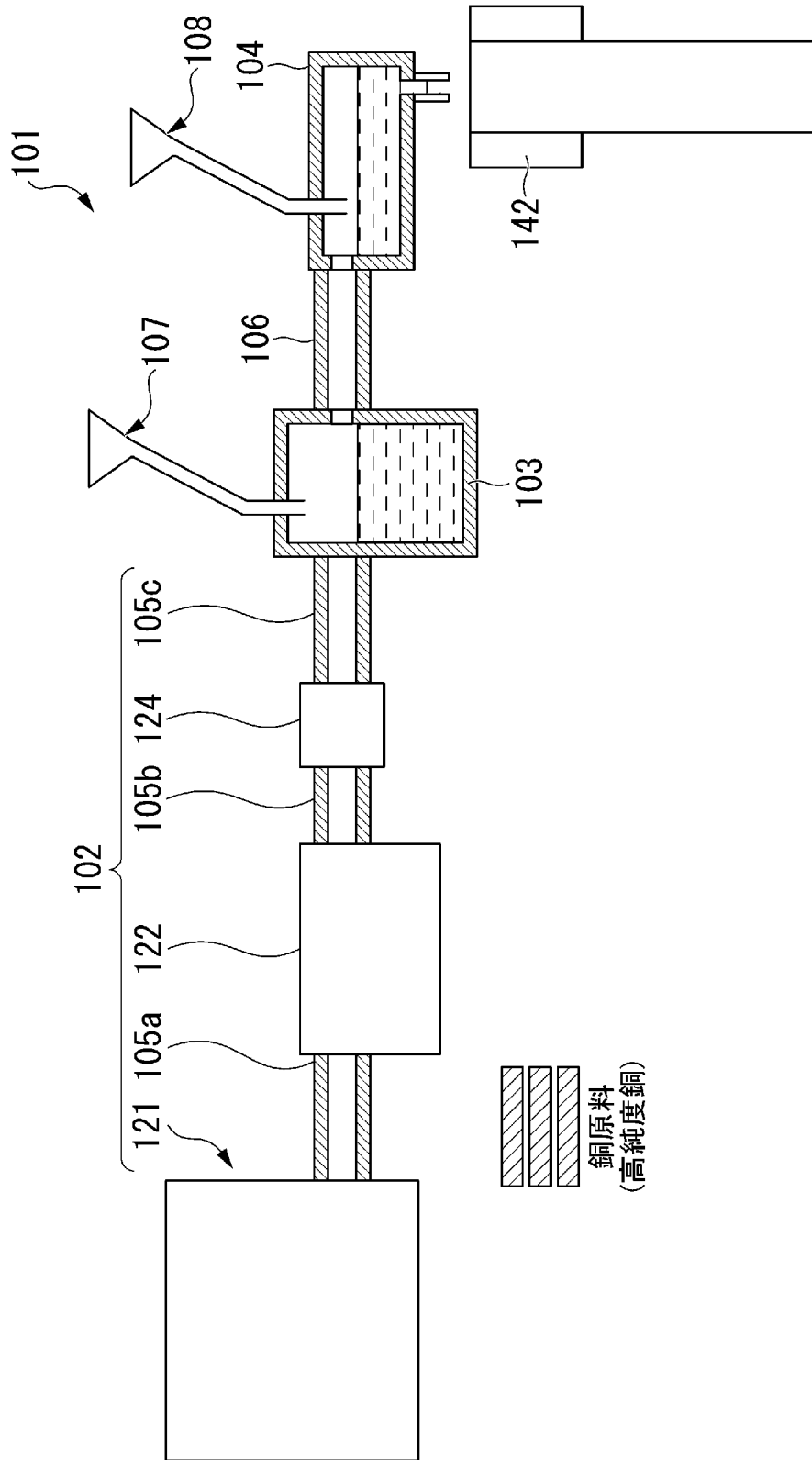
[図8]



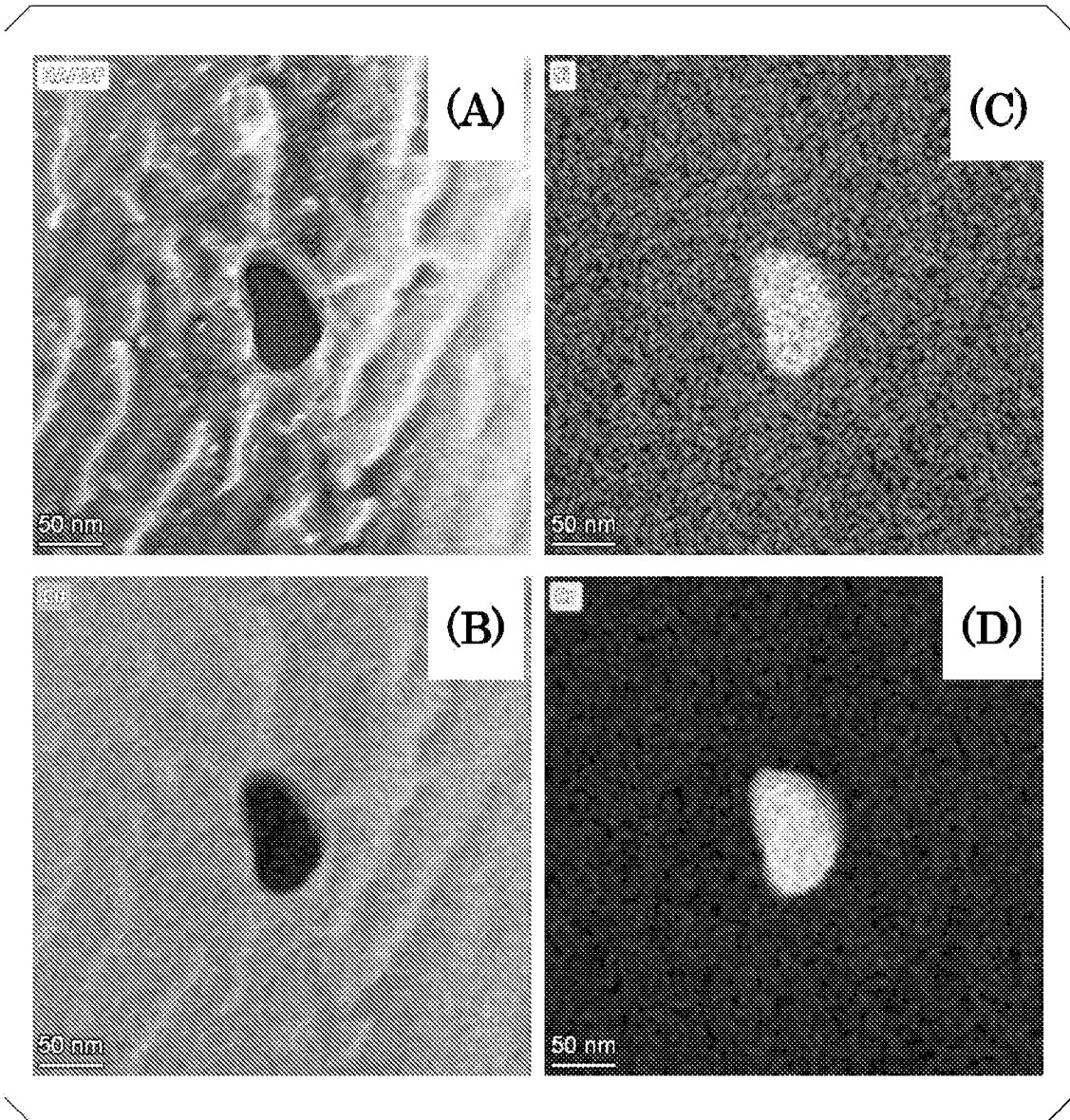
[図9]



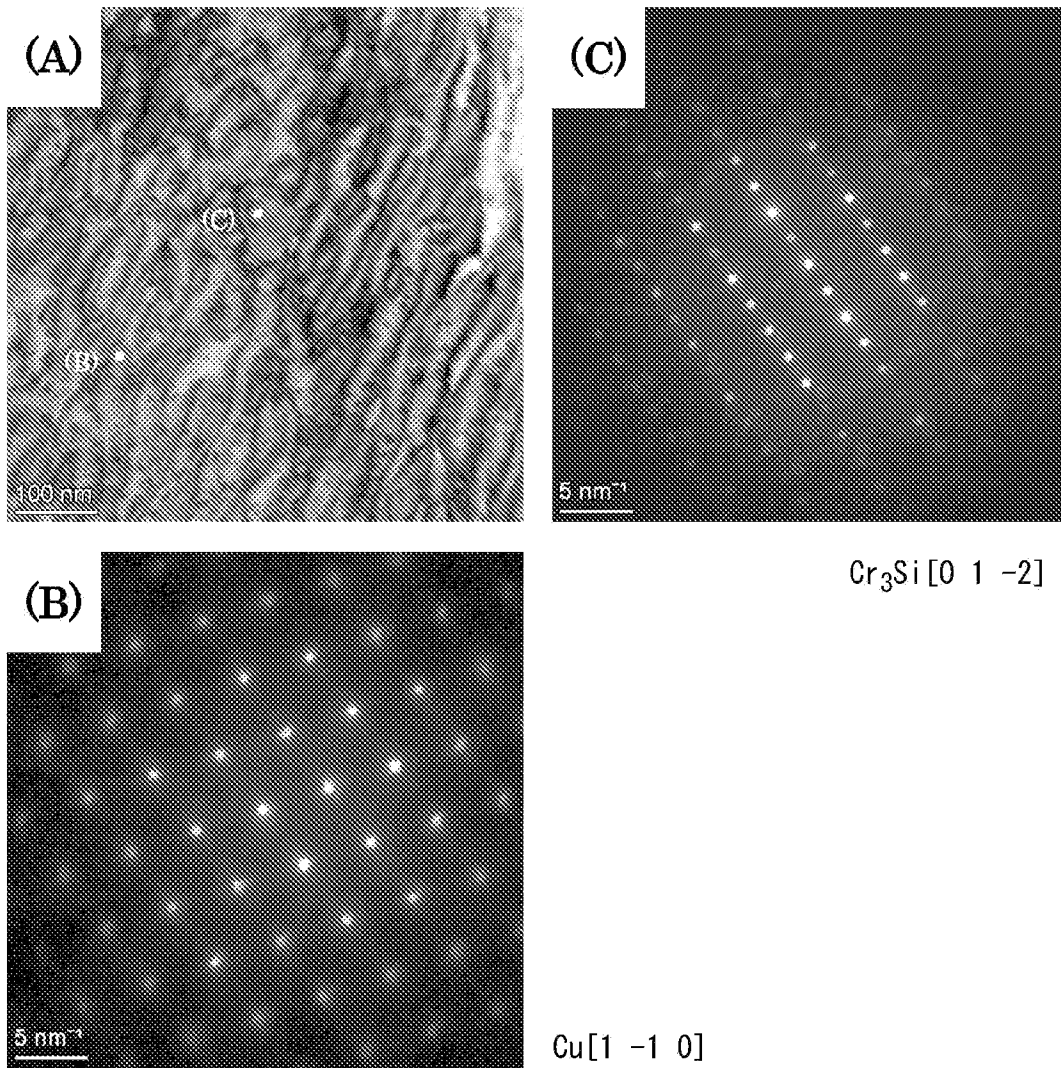
[図10]



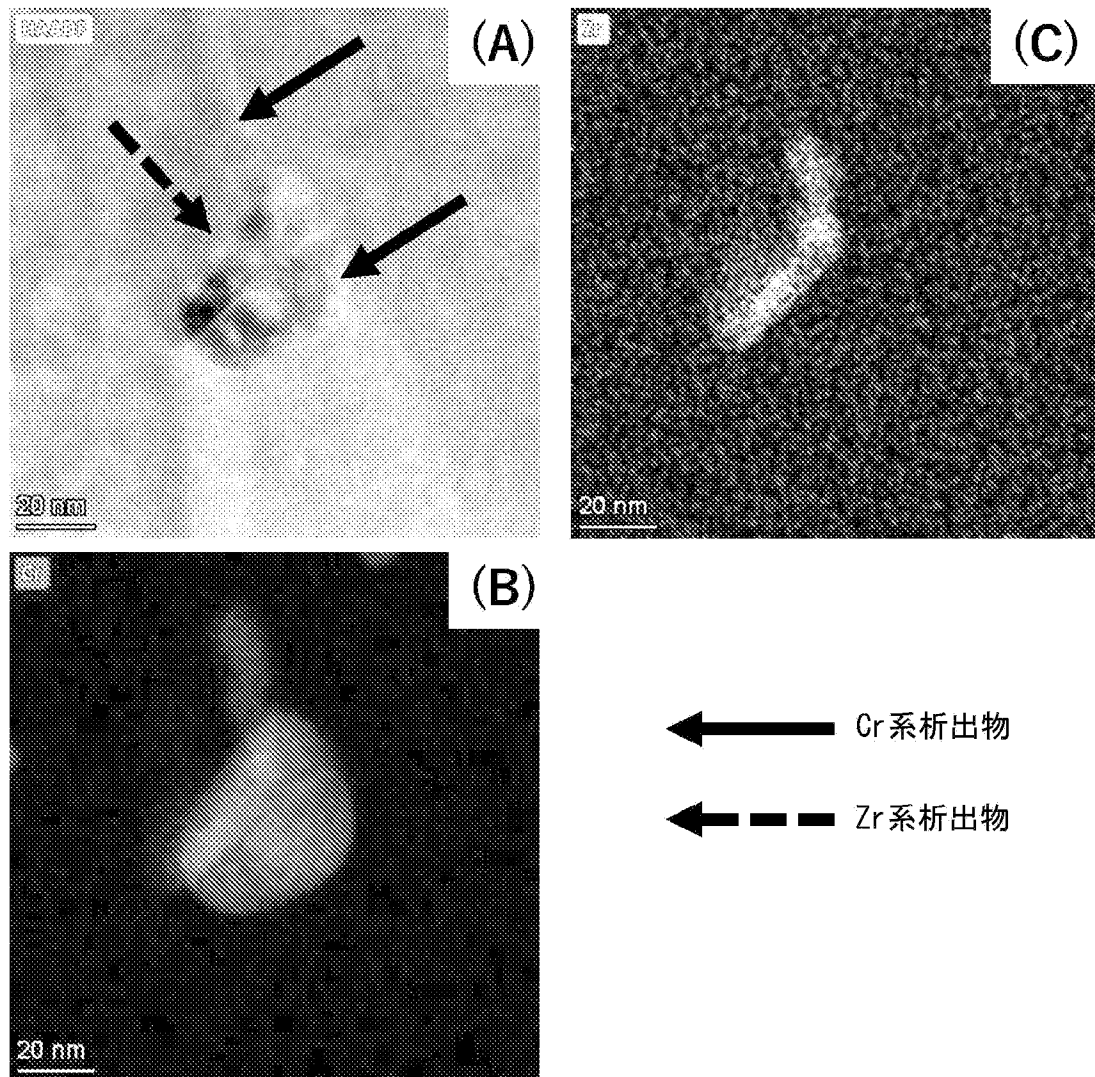
[図11]



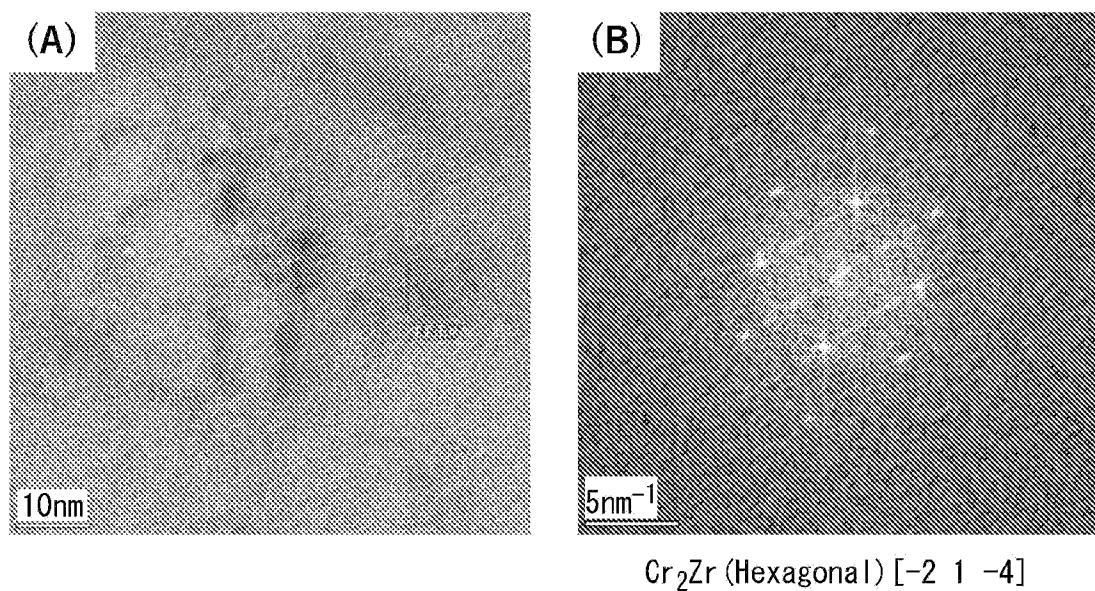
[図12]



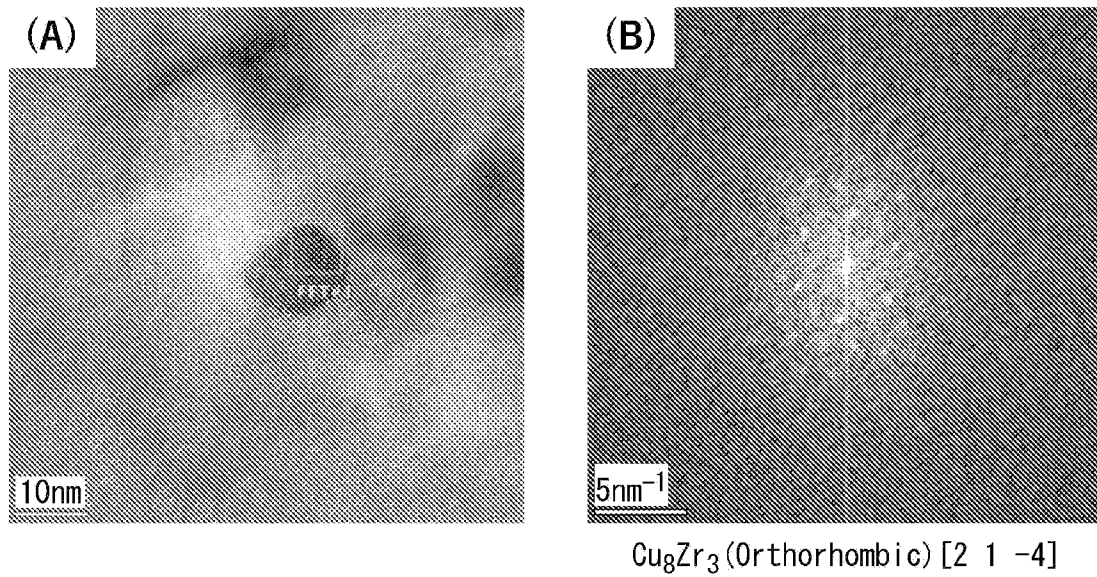
[図13]



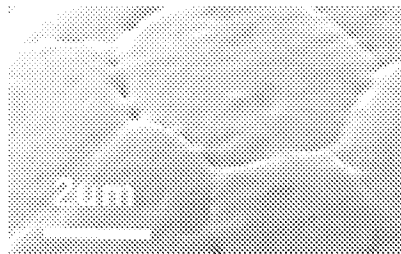
[図14]



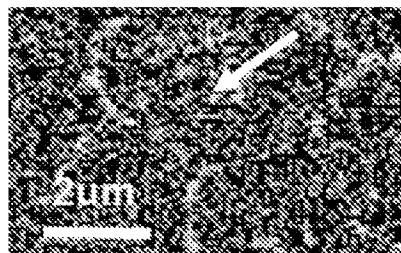
[圖15]



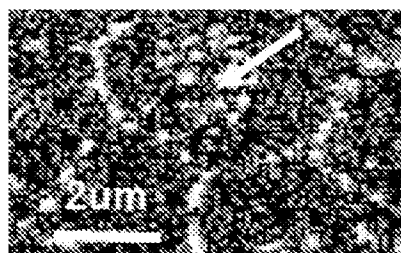
[圖16A]



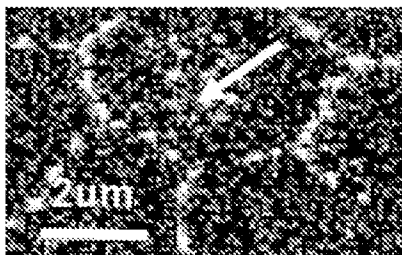
[圖16B]



[圖16C]



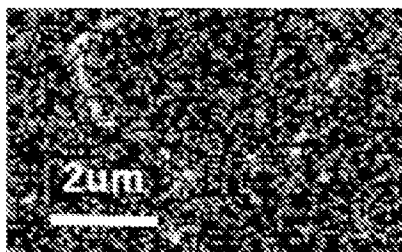
[図16D]



[図16E]



[図16F]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/038395

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B22F 1/00(2022.01)i; **B22D 11/00**(2006.01)i; **B22F 1/052**(2022.01)i; **B22F 1/16**(2022.01)i; **B22F 3/24**(2006.01)i; **B22F 9/08**(2006.01)i; **B22F 10/00**(2021.01)i; **B22F 10/28**(2021.01)i; **B22F 10/34**(2021.01)i; **B22F 10/38**(2021.01)i; **B22F 10/64**(2021.01)i; **B33Y 10/00**(2015.01)i; **B33Y 70/00**(2020.01)i; **C22C 9/00**(2006.01)i; **C22C 9/06**(2006.01)i
 FI: B22F1/00 L; B22D11/00 D; B22F1/052; B22F1/16; B22F3/24 C; B22F9/08 A; B22F10/00; B22F10/28; B22F10/34; B22F10/38; B22F10/64; B33Y10/00; B33Y70/00; C22C9/00; C22C9/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B22F1/00; B22D11/00; B22F1/052; B22F1/16; B22F3/24; B22F9/08; B22F10/00; B22F10/28; B22F10/34; B22F10/38; B22F10/64; B33Y10/00; B33Y70/00; C22C9/00; C22C9/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996
 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2023
 Registered utility model specifications of Japan 1996-2023
 Published registered utility model applications of Japan 1994-2023

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 111676386 A (SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO., LTD.) 18 September 2020 (2020-09-18) claims 1-6, paragraphs [0001], [0030]-[0057], fig. 1, 2	1-8
Y	JP 2015-132008 A (KOBEL STEEL, LTD.) 23 July 2015 (2015-07-23) claims 1-2, paragraphs [0003], [0005], [0011]-[0043], tables 1-3, fig. 1	1-8
Y	WO 2019/239655 A1 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) 19 December 2019 (2019-12-19) claims 1-16, paragraphs [0012], [0019]-[0045], table 1	4-8
A		1-3
Y	CN 112391556 A (CENTRAL SOUTH UNIVERSITY) 23 February 2021 (2021-02-23) claims 1-10, paragraphs [0004], [0043]-[0076], fig. 1-3	4-8
A		1-3

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 November 2023

Date of mailing of the international search report

12 December 2023

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
 Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/038395

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2020-186429 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP.) 19 November 2020 (2020-11-19) entire text	1-8
A	JP 2020-059913 A (NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS CORP.) 16 April 2020 (2020-04-16) entire text	1-8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No. PCT/JP2023/038395

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN 111676386 A	18 September 2020	(Family: none)	
JP 2015-132008 A	23 July 2015	US 2015/0200033 A1 claims 1-2, paragraphs [0006]-[0008], [0015]-[0043], tables 1-3, fig. 1 CN 104775048 A DE 102014019153 A1 KR 10-2015-0085482 A	
WO 2019/239655 A1	19 December 2019	(Family: none)	
CN 112391556 A	23 February 2021	(Family: none)	
JP 2020-186429 A	19 November 2020	(Family: none)	
JP 2020-059913 A	16 April 2020	(Family: none)	

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>B22F 1/00(2022.01)i; B22D 11/00(2006.01)i; B22F 1/052(2022.01)i; B22F 1/16(2022.01)i; B22F 3/24(2006.01)i; B22F 9/08(2006.01)i; B22F 10/00(2021.01)i; B22F 10/28(2021.01)i; B22F 10/34(2021.01)i; B22F 10/38(2021.01)i; B22F 10/64(2021.01)i; B33Y 10/00(2015.01)i; B33Y 70/00(2020.01)i; C22C 9/00(2006.01)i; C22C 9/06(2006.01)i FI: B22F1/00 L; B22D11/00 D; B22F1/052; B22F1/16; B22F3/24 C; B22F9/08 A; B22F10/00; B22F10/28; B22F10/34; B22F10/38; B22F10/64; B33Y10/00; B33Y70/00; C22C9/00; C22C9/06</p>																							
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>B22F1/00; B22D11/00; B22F1/052; B22F1/16; B22F3/24; B22F9/08; B22F10/00; B22F10/28; B22F10/34; B22F10/38; B22F10/64; B33Y10/00; B33Y70/00; C22C9/00; C22C9/06</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2023年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年													
日本国実用新案公報	1922 - 1996年																						
日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年																						
日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年																						
日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年																						
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>CN 111676386 A (SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO., LTD.) 18.09.2020 (2020 - 09 - 18) 請求項1-6, 段落[0001],[0030]-[0057], 図1-2</td> <td>1-8</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2015-132008 A (株式会社神戸製鋼所) 23.07.2015 (2015 - 07 - 23) 請求項1-2, 段落[0003],[0005],[0011]-[0043], 表1-3, 図1</td> <td>1-8</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>WO 2019/239655 A1 (古河電気工業株式会社) 19.12.2019 (2019 - 12 - 19) 請求項1-16, 段落[0012],[0019]-[0045], 表1</td> <td>4-8</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 112391556 A (CENTRAL SOUTH UNIVERSITY) 23.02.2021 (2021 - 02 - 23) 請求項1-10, 段落[0004],[0043]-[0076], 図1-3</td> <td>4-8</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>1-3</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p> <p>* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献</p>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	Y	CN 111676386 A (SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO., LTD.) 18.09.2020 (2020 - 09 - 18) 請求項1-6, 段落[0001],[0030]-[0057], 図1-2	1-8	Y	JP 2015-132008 A (株式会社神戸製鋼所) 23.07.2015 (2015 - 07 - 23) 請求項1-2, 段落[0003],[0005],[0011]-[0043], 表1-3, 図1	1-8	Y	WO 2019/239655 A1 (古河電気工業株式会社) 19.12.2019 (2019 - 12 - 19) 請求項1-16, 段落[0012],[0019]-[0045], 表1	4-8	A		1-3	Y	CN 112391556 A (CENTRAL SOUTH UNIVERSITY) 23.02.2021 (2021 - 02 - 23) 請求項1-10, 段落[0004],[0043]-[0076], 図1-3	4-8	A		1-3
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号																					
Y	CN 111676386 A (SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO., LTD.) 18.09.2020 (2020 - 09 - 18) 請求項1-6, 段落[0001],[0030]-[0057], 図1-2	1-8																					
Y	JP 2015-132008 A (株式会社神戸製鋼所) 23.07.2015 (2015 - 07 - 23) 請求項1-2, 段落[0003],[0005],[0011]-[0043], 表1-3, 図1	1-8																					
Y	WO 2019/239655 A1 (古河電気工業株式会社) 19.12.2019 (2019 - 12 - 19) 請求項1-16, 段落[0012],[0019]-[0045], 表1	4-8																					
A		1-3																					
Y	CN 112391556 A (CENTRAL SOUTH UNIVERSITY) 23.02.2021 (2021 - 02 - 23) 請求項1-10, 段落[0004],[0043]-[0076], 図1-3	4-8																					
A		1-3																					
<p>国際調査を完了した日</p> <p>24.11.2023</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>12.12.2023</p>																						
<p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>中西 哲也 4E 1191</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3425</p>																						

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2020-186429 A (三菱マテリアル株式会社) 19.11.2020 (2020 - 11 - 19) 全文	1-8
A	JP 2020-059913 A (株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ) 16.04.2020 (2020 - 04 - 16) 全文	1-8

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2023/038395

引用文献	公表日	パテントファミリー文献	公表日
CN 111676386 A	18.09.2020	(ファミリーなし)	
JP 2015-132008 A	23.07.2015	US 2015/0200033 A1 請求項1-2, 段落[0006]- [0008], [0015]-[0043], 表 1-3, 図1 CN 104775048 A DE 102014019153 A1 KR 10-2015-0085482 A	
WO 2019/239655 A1	19.12.2019	(ファミリーなし)	
CN 112391556 A	23.02.2021	(ファミリーなし)	
JP 2020-186429 A	19.11.2020	(ファミリーなし)	
JP 2020-059913 A	16.04.2020	(ファミリーなし)	